

## 業 務

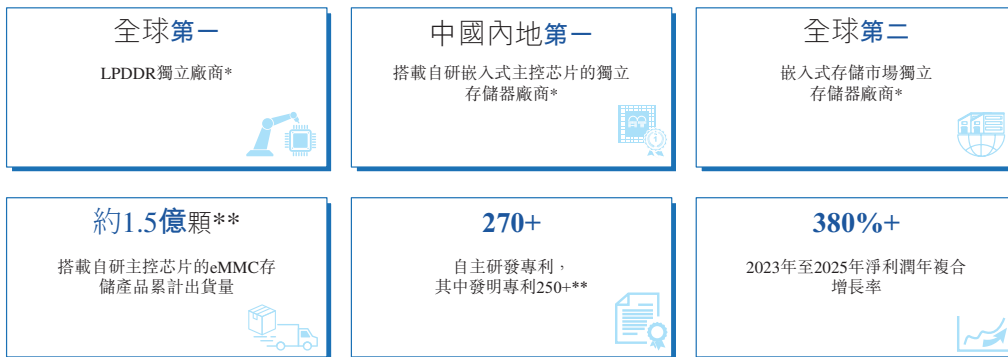
### 概覽

我們是中國內地領軍嵌入式存儲產品獨立廠商，主要專注於嵌入式存儲產品及其他存儲產品的研發、設計、測試（作為生產流程的重要環節）和銷售。我們的嵌入式存儲產品包括基於DRAM的產品、基於NAND Flash的產品及多芯片封裝嵌入式存儲產品。我們的其他產品主要包括固態硬盤和內存條。我們還就其他第三方提供的產品為部分客戶提供測試服務。

我們的核心技術團隊在嵌入式存儲器領域深耕約二十年，打造了獲得客戶廣泛認可的RAYSON®和ARTMEM®品牌。我們的產品應用於多元化的終端領域，包括消費電子產品，例如智能手機、筆記本電腦、平板電腦、教育電子、智慧家居、可穿戴設備及智能機器人，同時也涵蓋工業領域和智能座艙系統，並為上述終端設備提供高性能、高可靠性及高耐用性的數據存取能力。面向AI全域變革，我們為上述終端設備的全面AI化轉型升級提供存儲應用技術的賦能，為AI手機、AI PC、機器人及智能座艙系統等跨時代產品落地提供富有市場競爭力的存儲方案。

我們專注於存儲應用技術的研發與創新，已經成功形成核心技術能力。我們憑藉領先的技術研發創新能力、安全強韌的供應鏈生態、生產管理體系、敏捷高效的客戶服務水平，持續保持行業領先地位。

下圖列示我們於往績記錄期間取得的主要成就。

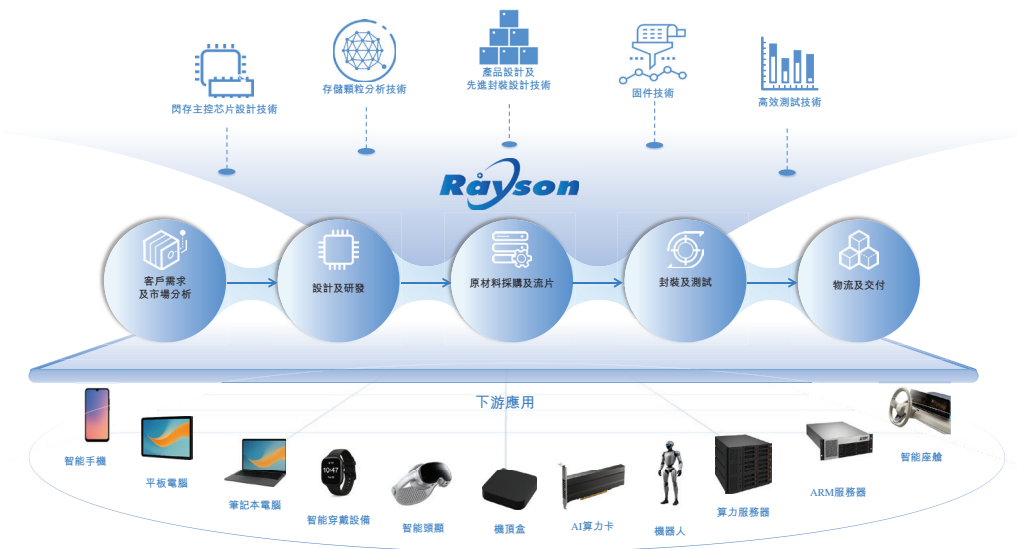


\* 根據弗若斯特沙利文的資料，以2024年出貨量計

\*\* 截至最後實際可行日期

## 業 務

下圖展示了我們的商業模式，涵蓋研發、生產和商業化流程的關鍵環節，以及產品的終端應用。



我們的收入由2023年的人民幣24億元增加54.6%至2024年的人民幣37億元，並進一步增加59.4%至2025年的人民幣59億元。於2023年、2024年及2025年，我們的淨利潤分別為人民幣37.0百萬元、人民幣88.9百萬元及人民幣879.9百萬元。

### 我們的競爭優勢

**領軍獨立存儲器廠商，具備強大實力，把握市場發展機遇，適應客戶需求**

我們是全球領軍獨立存儲器廠商。根據弗若斯特沙利文的報告，以2024年出貨量計，我們在全球嵌入式存儲市場所有獨立存儲器廠商中排名第二，在全球LPDDR獨立廠商中排名第一，在位於中國內地搭載自研嵌入式主控芯片的獨立存儲器廠商中排名第一。根據弗若斯特沙利文的資料，相較於擁有晶圓製造能力的存儲原廠，我們作為獨立存儲器廠商的優勢主要體現在「離應用更近、離客戶更近、離場景更近」，專注於滿足細分市場的需求，特別是，我們能在滿足客戶通用性需求之外，滿足其定制化需求。

我們能夠為客戶提供更具定制化和差異化的產品。這包括針對特定應用場景，如新興的物聯網設備、邊緣計算、工業控制、智能座艙等，進行優化，提供更廣泛的

---

## 業 務

---

容量選擇或特殊封裝形式，以及針對靈活批量、多品類的訂單提供更快速的響應。此外，我們對細分市場有著深刻的理解，具有快速響應客戶需求的能力。通過與客戶的緊密聯繫，且憑藉我們在研發、設計及生產方面的能力，我們高效地交付量身定制的產品，同時整合及利用供應鏈上下游資源，確保及時有效的交付。

我們通過深入挖掘存儲顆粒的特性，可以推出更具差異化的產品解決方案，更好地滿足客戶的個性化需求，並在多樣化的終端應用場景中提升系統的穩定性、效率和整體成本效益。此外，我們提供全面且具差異化的先進封裝設計與仿真能力，能夠根據客戶對外形尺寸、性能及能效的具體要求，量身定制成本優化的高可靠性解決方案，尤其適用於汽車及工業應用領域。在客戶管理及支持方面，我們提供代碼級技術支持、標準化封測與質量控制、單一芯片追溯能力，並設有專門的技術支持團隊，以確保快速響應、系統穩定運行及持續可靠的交付。

此外，我們正積極抓住市場機遇佈局端側AI解決方案，在整合現有產品及技術優勢基礎上，為搭載端側AI的智能終端量身定制從芯片級到算法級的產品和解決方案，以滿足端側AI不斷發展的存儲需求。為了更好的完善我們在端側AI的解決方案，我們亦拓展了固態硬盤與內存條產品，部分產品已經於往績記錄期間進入全球知名廠商的AI生態中。

### 我們擁有全面的研發能力，以持續的研發和創新構築可持續的競爭優勢

我們已經通過自主研發和創新，構建涵蓋核心技術的全面研發能力。技術創新始終是我們贏得市場競爭並取得領先地位的關鍵驅動力。

我們掌握閃存主控芯片設計技術，這使我們能夠深刻理解產品需求與設計實現之間的關係，從而顯著提升嵌入式存儲解決方案的性能、可靠性及整體競爭力。我們的存儲顆粒分析技術可以通過對於DRAM和NAND顆粒進行分析，支持量產測試算法的開發和優化，從而提升產品質量和可靠性。我們的產品設計及先進封裝設計技術，可針對客戶不同需求設計定制高性能、高可靠性、長期穩定性與安全性的高質量產品。我們的固件技術包括UFS及eMMC固件技術。我們自主研發所有閃存產品的固件，並對核心算法擁有完整的知識產權。

---

## 業 務

---

我們的高效測試技術，能夠高效、準確、持續地保證量產的嵌入式存儲產品在複雜環境下的長期穩定性和可靠性。我們已經自主研發並建立多個測試平台，顯著提升測試效率，提升準確性，並提升客戶在量產過程中的成功率，實現終端產品的卓越效能與品質。此外，通過自主研發的測試算法及測試方案，我們能夠將存儲產品滿足車規級和工規級應用的高質量標準，例如嚴苛溫度下的要求。

我們已經在多個產品類別、多個應用領域上取得了突破性成就。截至最後實際可行日期，我們是中國內地首批量產搭載自研主控的UFS存儲芯片的獨立存儲器廠商，也是中國內地最早量產搭載自研主控的eMCP和ePOP存儲芯片的獨立存儲器廠商。我們是中國最早量產16G容量LPDDR4X的獨立存儲器廠商。截至2025年12月31日，我們是中國LPDDR規格最全的獨立存儲器廠商；以獲授發明專利數量計，我們在中國內地獨立存儲器廠商中排名第二。我們是中國最早在一家全球領先AI PC平台量產LPDDR5X的獨立存儲器廠商。我們是中國最大智能終端人機交互解決方案提供商的首家AI服務器、AI邊緣計算加速卡等高性能算力設備LPDDR合作夥伴。我們是首個為全球第三大計算平台開發嵌入式存儲主控芯片的中國合作夥伴。

我們採用內部創新與以客戶為導向相結合的研發策略，確保充分考慮不斷變化的市場需求下進行產品開發及設計。我們的技術及研發團隊包括在半導體行業研發、設計及／或製造方面具備豐富經驗的高級專家與工程師。我們的核心研發團隊平均從業年限超過15年。請參閱本節「一 研發」。

### **深厚的行業積累讓我們建立了安全強韌的供應鏈生態**

經過多年的行業積累，我們與核心供應商保持長期合作關係，能夠在保證供應鏈彈性的同時，確保供應的高效和穩定。

---

## 業 務

---

**長期穩定且可持續的供應鏈關係。**我們與國內外領先的存儲晶圓及存儲顆粒廠建立了穩定的合作關係。我們也是全球及中國頂級晶圓及存儲顆粒製造商在中國內地的主要合作夥伴，使得我們能夠持續、穩定地獲取晶圓及存儲顆粒，及時滿足我們產品的交貨週期。該供應鏈能力構成核心競爭優勢，增強我們吸引及留住客戶的能力。

**具備身位優勢的供應鏈生態地位。**深度與具備身位優勢的技術交流與合作，使得我們能夠全面理解我們供應鏈的技術特點與優勢，精準適配我們產品，並可獲得合作夥伴更為優先與全面的支持，提前佈局新產品，搶佔市場先機。通過與供應鏈夥伴的長期緊密合作，我們在車規級存儲器、LPDDR5/5X以及DRAM存儲技術及產品等先進的存儲技術領域取得了多項開創性成果。

**深度且富有價值的技術交流反饋。**我們亦利用自身領先的存儲器測試技術為存儲顆粒廠商賦能，為其提供詳細的分析報告，探究存儲顆粒可能存在的不足或瑕疵及其產生的原因，並與其緊密合作以優化存儲顆粒、主控芯片及固件算法之間的兼容性。我們亦將來源於終端設備對於存儲顆粒的需求與訴求及時反饋給存儲顆粒廠商，協助其不斷優化參數、改進工藝，綜合提升雙方的產品良率。

**我們堅持品質至上的生產管理體系和卓越高效的客戶服務水平，為客戶創造持久價值。**

根據弗若斯特沙利文的資料，嵌入式存儲器裝載至智能終端設備之上後便難以輕易更換，且其性能與可靠性直接影響終端產品的功能、質量與市場口碑。客戶在選擇嵌入式存儲器供應商時，一般會進行嚴格審查，需要經過多輪篩選和驗證流程，以確保兼容性、性能和可靠性。由於嵌入式存儲器在組裝到終端設備後難以更換、重新設計和驗證成本高昂，一旦供應商獲批准及其產品被設計導入終端設備中，客戶一般很少更換供應商。因此，品質可靠、穩定、耐久是嵌入式存儲器廠商的核心競爭力。在具備核心技術優勢和供應鏈優勢的基礎上，我們始終堅持品質至上的生產管理體系和卓越高效的客戶服務水平，為客戶帶來有形價值，贏得長期信任。

---

## 業 務

---

我們擁有健全的質量控制檢測流程與關鍵質量控制點，嚴格控制產品從原料入廠到成品出廠的每個環節，及時準確地進行品質記錄，做到可分析、可追溯，有效保障產品的品質。通過先進的生產管理平台和品質控制軟件實現生產流程的即時監控和資料分析，並主動解決潛在問題。這不僅提升了生產效率和產品品質，也增強了對市場需求和客戶要求的快速回應能力。

我們在貼近客戶的地區佈局專業的商務團隊、研發團隊、技術支持團隊、品質管理團隊，能夠快速回應、準確理解並積極落實客戶需求，主動提供定制化的解決方案，包括高效優質的交付服務、技術支援和售後保障。通過將技術能力與靈活的以客戶為導向的方法相結合，我們在性能、可靠性與成本要求之間實現平衡。我們的能力使我們能夠在客戶產品開發和製造的各個階段提供積極支持，確保無縫整合、性能優化和按時交付，在競爭激烈的市場中實現其戰略目標。我們一直採取積極進取的前瞻性服務方略，認真傾聽客戶需求並利用我們出眾的技術實現能力提供精確符合其規格的解決方案。

為客戶持續創造價值，既是我們賴以生存的根基，也是驅動我們長期增長的引擎。我們憑藉穩健多元的供應鏈佈局、自主研發的核心技術、貫穿設計－測試全流程的品質管控體系，以及覆蓋售前、售中、售後的卓越客戶服務，能夠以更具競爭力的成本提供性能穩定、品質一致的產品組合。

### 我們富有遠見的管理團隊，堅持鼓勵創新及工匠精神的企業文化

我們的管理團隊具備豐富的行業背景和卓越的領導經驗。截至2025年12月31日，我們的高級管理層平均擁有超過15年的生產及管理關鍵環節經驗，為公司的技術突破和業務拓展提供了堅實支撐。這種深厚的行業與管理經驗，使管理層能夠制定切實可行且富有前瞻性的戰略，有效應對市場變化與挑戰，確保公司的持續增長。我們的企業文化強調創新與工匠精神，營造鼓勵員工提出新思路和解決方案的環境，推動持續改進和技術創新。通過高效的內部溝通機制，我們能夠緊密把握市場動態和客戶需求，從而快速調整運營策略，保持競爭優勢。

---

## 業 務

---

### 我們的發展戰略

#### 全面擁抱端側AI，推動存儲器技術與產品發展

根據弗若斯特沙利文的資料，AI大模型的運行通常需要處理海量數據並進行複雜計算，對於存儲器的容量、速率和能效提出了極高要求。我們開發的LPDDR產品擁有大容量、高速率、高帶寬及低功耗等顯著優勢，能夠很好的適配ARM、RISC-V和X86架構，在AI大模型訓練與推理方面具有獨特的競爭優勢。我們將全面擁抱端側AI，積極佈局下一代存儲器技術和產品，並且積極地與我們的生態夥伴一道完成AI產業落地。

具體而言，我們將提前佈局端側AI所需存儲器技術，並與客戶、供應商、主控平台等合作夥伴合作，提前進行產品的市場盡調、產品預研、樣品測試，作為標桿產品率先推向市場。我們將戰略性佈局AI手機、PC、可穿戴設備和物聯網設備、智能機器人和智能座艙，抓住AI全面重新定義智能終端的價值機遇，這代表存儲解決方案的龐大市場，並反映未來先進生產力的發展方向。與全球頂尖終端品牌加強戰略合作是我們躋身核心供應鏈、撬動增量市場的關鍵砝碼。我們將加強與AI終端生態的「標桿」企業建立常態化戰略關係，通過在存儲性能、功耗及可靠性上的差異化優勢及持續創新，完成SoC平台的技術對接與平台認證，從而在生態協同創新中佔據先發位置。

#### 快速推進工規級與車規級市場，構建全面的產品體系

我們高度重視工規級與車規級市場，並將其視為未來的重要發展目標。我們將利用在嵌入式存儲器領域鍛煉積累的技术實力與品質實力，快速推進工規與車規級市場。

我們現已推出專為車載和工業領域涉及的嵌入式存儲產品體系，包括LPDDR4/4X及eMMC等。我們的工規級嵌入式存儲產品已成功進入多家工業及智能製造領域客戶的供應鏈，成功應用於電網、網絡通信、工業控制等領域，未來將繼續開拓智慧醫療、軌道交通等細分應用場景。我們的車規級eMMC與LPDDR產品均已通過嚴苛的AEC-Q100車規認證，嵌入式存儲器已應用於多家前裝汽車廠商的智能座艙和車

---

## 業 務

---

載信息娛樂系統中。我們未來將繼續開拓更多頭部汽車品牌終端客戶，在智能座艙領域持續發力。同時，我們積極推進車工規領域與SoC平台的技術對接與平台認證，與更多頭部品牌達成合作夥伴關係。

### 打造戰略性行業共榮生態，尋求內生外延協同成長

我們擬打造戰略性行業共榮生態，尋求內生外延的共同成長。

我們的產品已進入眾多知名智能終端廠商的供應鏈體系，進行「芯片－系統－應用場景」的協同開發，共同打造了眾多細分領域內的標桿性最佳產品實踐。此外，我們也與同為智能終端上游的企業精誠合作，通過行業頭部的SoC平台認證，實現更深度的平台適配與更高靈活度的個性化定制。此外，我們將聚焦存力，服務普惠與效能提升，強化技術攻關與產業協同生態構建。

為有效達成上述目標，我們在尋求內生增長的同時，亦將加強新技術、領域、產品的戰略孵化，快速完善產品線，加深市場滲透。同時，我們密切關注行業優質標的，並抓住合適的窗口期進行併購整合，推動公司快速成長，與內生增長有機結合。

### 深化全球擴張戰略，打造國際化存儲科技品牌

我們致力於進行全球化的戰略擴張，打造國際化的存儲科技品牌。

展望未來，我們將進一步加快開拓海外市場，建立海外銷售和技術服務中心，積極獲取境外市場資訊及客戶訴求，實現差異化的產品定義，提升全球客戶的支持響應速度，綜合提升國際市場競爭力，為全球智能終端客戶與廣大消費者帶來全新的存儲體驗。

我們的主要舉措包括：(i)構建本地化產品矩陣，方式為充分利用深厚的技術能力，為全球不同區域市場定義不同產品。我們將根據不同的客戶特徵及應用需求，有針對性地開發面臨不同海外市場的嵌入式存儲產品及解決方案，涵蓋高性能消費電子、受監管驅動的汽車及工業應用、前沿人工智能計算及成本敏感的物聯網場景；(ii)建立全球銷售體系，方式為與全球市場的頭部客戶建立戰略合作關係，共同開發當地市場。我們將在國際客戶集中的地區建立營銷中心，實現廣泛市場覆蓋。截至最後實際可行日期，我們正在考慮客戶基礎、稅務及外匯事宜以及當地整體營商環境以評估有潛力的地區；及(iii)完善全球供應鏈佈局，方式為逐步完善全球供應鏈與產品佈局，

---

## 業 務

---

提升我們的海外產能與供應能力。這包括與當地技術先進、質量可靠的封測廠合作，為客戶提供技術優化且具成本效益的解決方案，並逐步在目標市場或周邊地區建設工廠，實現本地化生產。

### 我們的業務模式

於往績記錄期間，我們主要專注於嵌入式存儲產品及其他存儲產品的研發、設計、生產和銷售。我們的業務模式涵蓋嵌入式存儲產品的核心領域，依託創新的系統級解決方案、先進的芯片研發能力以及在集成電路和固件方面的持續投入為支撐。

- **研發：**我們採用內部創新與以客戶為導向相結合的研發策略，在充分考慮不斷變化的市場需求下進行產品研發及設計。我們在閃存主控芯片、存儲顆粒分析、產品設計及先進封裝設計、固件技術及高效測試技術等多個關鍵領域積累了多項自主研發的技術，使我們能夠持續拓展及開發具有競爭力的存儲解決方案及服務。
- **生產：**我們在整個生產流程中擔當主導角色。我們負責閃存主控芯片設計、固件設計、封裝設計，原材料採購及質量控制，以及我們的兩家智能製造中心實施的測試環節。在測試過程中，我們綜合考慮多方面因素，包括上游元器件特性、中游平台兼容性以及下游客戶的應用需求，以選擇最合適的測試程序，確保一致的產品質量及高效的流程。憑藉豐富的實踐經驗，我們積累重要的專有技術，能夠對上游元件進行精準、多維度的測試。我們與中游SoC平台保持緊密合作，降低測試失誤率，並通過與下游客戶的深度溝通，確保測試更貼近實際應用需求。整個流程確保了測試環節的高效、精準及一致性，為產品質量及客戶滿意度提供堅實保障。

我們根據行業慣例，優選經驗豐富、資質堅實的第三方按照我們的專有規範及工藝要求進行芯片流片與封裝工序，使我們既能確保產品在一致性及系統兼容性上的嚴格標準，又能在成本與效率之間取得平衡，從而提升我們整體生產的靈活性與競爭力。

## 業 務

- **商業化**：憑藉我們良好的市場聲譽及客戶的高度認可，並依託直接客戶合作及完善的經銷合作網絡，我們的產品已成功進入中國消費電子行業多個細分領域的多家知名企業供應鏈，包括領先／卓越的智能手機廠商、平板電腦與智能可穿戴設備品牌、電信及網絡設備供應商、智慧家電品牌，以及工業和企業設備解決方案提供商。隨著這些領域AI應用不斷深化，我們預計將迎來更多增長及擴張機遇。

### 我們的產品組合

下表載列於所示年度按主要產品類別劃分的總收入明細。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
<b>嵌入式存儲產品</b>						
基於DRAM的產品						
(DDR、LPDDR) .....	1,658,683	69.1	2,474,303	66.6	3,744,369	63.3
基於NAND Flash的產品						
(eMMC、UFS) .....	319,339	13.3	673,647	18.1	1,593,344	26.9
多芯片封裝嵌入式存儲產品						
(eMCP、uMCP、ePOP) .....	305,927	12.7	311,770	8.4	160,953	2.7
小計 .....	<b>2,283,949</b>	<b>95.1</b>	<b>3,459,720</b>	<b>93.2</b>	<b>5,498,666</b>	<b>92.9</b>
其他*	117,939	4.9	254,084	6.8	420,817	7.1
總計 .....	<b>2,401,888</b>	<b>100.0</b>	<b>3,713,804</b>	<b>100.0</b>	<b>5,919,483</b>	<b>100.0</b>

\* 其他主要包括固態硬盤、內存條及測試服務。

我們的產品組合主要包括消費級、工業級及車規級嵌入式存儲產品，廣泛應用於各種終端市場，包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、教育電子產品、智能電視、可穿戴設備、工業控制系統及汽車電子產品。消費級、工業級和車規級產品分別滿足不同應用需求，並在不同的技術要求下運行。消費級產品主要應用於大眾消費電子設備，工作溫度範圍為0°C至+70°C，就若干產品而言則為-25°C至+85°C，產品週期相對較短，使用壽命一般為1-3年，並需符合相應的消費類標準。工業級產品用於更為嚴苛的工業環境，典型工作溫度為-40°C至+85°C，具備更高的耐受性和耐用性，符合相關工業標準，產品週期較長，設計壽命通常為五至十年。車規級產品用於汽車電子領

## 業 務

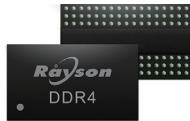
域，主要依據AEC-Q100標準按照溫度等級進行劃分，能夠在嚴格條件下運行，設計壽命可達15年，並常用於車載信息娛樂系統、智能座艙等應用場景。

於往績記錄期間，我們的消費級產品已融入多家國內領先電訊及智能設備製造商的供應鏈，並廣泛用於智能手機、平板電腦及可穿戴設備。我們的產品已通過電網基礎設施、通信網絡及工業自動化等行業主要參與者的認證，支持電力公用事業及機器人系統等應用。此外，我們的產品已批量生產並獲知名汽車廠商採用，為智能座艙及車載信息娛樂系統提供助力。此外，我們的高性能LPDDR產品已獲國內領先的芯片及系統解決方案廠商應用於其計算服務器和邊緣加速卡中。我們的固態硬盤產品也已融入多家全球半導體企業的AI PC生態系統，為雲端訓練及邊緣計算設備提供關鍵存儲支持。

下表載列我們截至2025年12月31日的主要產品，以及2025年銷售產品的指示性價格範圍。該等價格範圍僅供參考，並可能因應市況及其他相關因素不時作出調整。

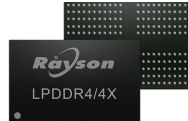
### 基於DRAM的產品

#### 消費級



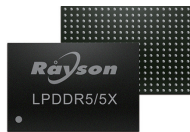
##### DDR4

- 容量：4Gb-16Gb
- 速率：3200Mbps
- 溫度範圍：0°C-95°C
- 價格範圍：人民幣10元至人民幣16元，價格差異主要歸因於產品密度不同。



##### LPDDR4/4X

- 容量：512MB-16GB
- 速率：高達4266Mbps
- 溫度範圍：-25°C-85°C
- 價格範圍：人民幣10元至人民幣172元，價格差異主要歸因於產品密度不同。



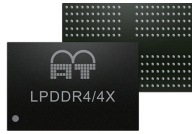
##### LPDDR5/5X

- 容量：2GB-32GB
- 速率：高達8533Mbps
- 溫度範圍：-25°C-85°C
- 價格範圍：人民幣32元至人民幣177元，價格差異主要歸因於產品密度不同。

## 業 務

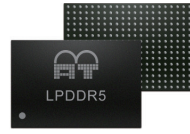


### 車工規級



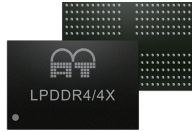
#### LPDDR4/4X (工規級)

- 容量：1GB-8GB
- 速率：高達4266Mbps
- 溫度範圍：-40°C-95°C
- 價格範圍：人民幣30元至人民幣130元，價格差異主要歸因於產品密度不同。



#### LPDDR5 (工規級)

- 容量：8GB-16GB
- 速率：6400Mbps
- 溫度範圍：-40°C-95°C
- 價格範圍：人民幣450元至人民幣900元，價格差異主要歸因於產品密度不同。



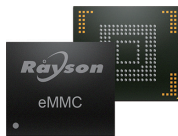
#### LPDDR4/4X (車規級)

- 容量：4GB-8GB
- 速率：4266Mbps
- 溫度範圍：-40°C-105°C
- AEC-Q100車規級認證標準
- 價格範圍：人民幣110元至人民幣540元，價格差異主要歸因於產品密度不同。

### 基於NAND Flash的產品及多芯片封裝產品

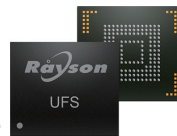


### 消費級



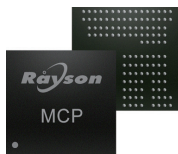
#### eMMC

- 技術：eMMC 5.1
- 容量：4GB-256GB
- 溫度範圍：-25°C-85°C
- 自研主控芯片
- 價格範圍：人民幣10元至人民幣90元，價格差異主要歸因於產品密度不同。



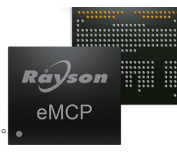
#### UFS

- 技術：UFS 2.2
- 容量：128GB-1TB
- 溫度範圍：-25°C-85°C
- 自研主控芯片
- 價格範圍：人民幣50元至人民幣140元，價格差異主要歸因於產品密度不同。



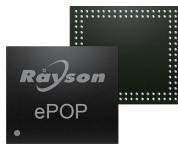
#### 多芯片封裝

- 存儲容量：4Gb+4Gb
- 速率：4266Mbps
- 溫度範圍：-25°C-85°C
- 價格範圍：約人民幣14元，價格差異主要歸因於產品密度不同。



#### eMCP

- 存儲容量：8GB-128GB
- DRAM容量：1GB-6GB
- 溫度範圍：-25°C-85°C
- 自研主控芯片
- 價格範圍：人民幣30元至人民幣60元，價格差異主要歸因於產品密度不同。



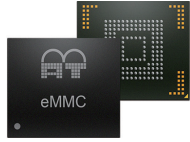
#### ePOP

- 存儲容量：32GB-64GB
- DRAM容量：2GB-4GB
- 溫度範圍：-25°C-85°C
- 自研主控芯片
- 價格範圍：人民幣100元至人民幣200元，價格差異主要歸因於產品密度不同。

## 業 務

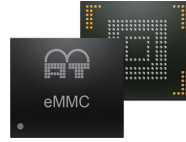


### 車工規級



#### eMMC (工規級)

- 技術：eMMC 5.1
- 容量：1Gb-128GB
- 溫度範圍：-40°C-85°C
- 自研主控芯片
- 價格範圍：人民幣8元至人民幣122元，價格差異主要歸因於產品密度不同。



#### eMMC (車規級)

- 技術：eMMC 5.1
- 容量：8GB
- 溫度範圍：-40°C-85°C
- 自研主控芯片
- AEC-Q100車規級認證標準
- 價格範圍：約人民幣30元

## 固態硬盤及內存條



### 消費級



#### SATA 固態硬盤

- 容量：128GB-1TB
- 溫度範圍：0°C-70°C
- 價格範圍：人民幣50元至人民幣320元，價格差異主要歸因於產品密度不同。



#### PCIe 3.0 固態硬盤

- 容量：256GB-2TB
- 溫度範圍：0°C-70°C
- 價格範圍：人民幣130元至人民幣700元，價格差異主要歸因於產品密度不同。



#### PCIe 4.0 固態硬盤

- 容量：512GB-4TB
- 溫度範圍：0°C-70°C
- 價格範圍：人民幣210元至人民幣1,150元，價格差異主要歸因於產品密度不同。



#### Memory DDR4

- 容量：8GB-32GB
- 速率：高達3200MT/s
- 溫度範圍：0°C-85°C
- 價格範圍：人民幣70元至人民幣750元，價格差異主要歸因於產品密度不同。



#### Memory DDR5

- 容量：8GB-32GB
- 速率：高達5600MT/s
- 溫度範圍：0°C-85°C
- 價格範圍：人民幣120元至人民幣530元，價格差異主要歸因於產品密度不同。

## 業 務

下表載列於所示年度我們按主要產品類別劃分的平均售價及銷量的明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	銷量	平均售價	銷量	平均售價	銷量	平均售價
	人民幣元		人民幣元		人民幣元	
(千顆)	/顆	(千顆)	/顆	(千顆)	/顆	
<b>嵌入式存儲產品</b>						
基於DRAM的產品 (DDR、LPDDR) .....	80,059	21	95,702	26	103,998	36
基於NAND Flash的產品 (eMMC、UFS) .....	26,214	12	41,611	16	60,326	26
多芯片封裝嵌入式存儲產品 (eMCP、uMCP、ePOP) .....	4,534	67	2,760	113	2,426	66

於往績記錄期間，我們主要產品銷量的增加或波動主要歸因於導致相關業務分部收入增加或波動的同一因素。我們基於DRAM的產品及基於NAND Flash的產品的平均售價出現波動，此乃主要由於半導體行業價格波動及我們根據對核心客戶的戰略重點及不斷變化的市場需求而進行產品組合調整所致。多芯片封裝嵌入式存儲產品分部的平均售價變動主要受整體市價波動及產品組合調整所推動。請參閱本文件「財務資料－經營業績主要組成部分說明－收入－銷量及平均售價」。

### 基於DRAM的產品 (LPDDR及DDR)

LPDDR及DDR是我們產品組合中的關鍵類別。自2018年以來，我們一直致力於LPDDR及DDR的研發、測試及銷售。截至2025年12月31日，我們提供1,581個SKU的基於DRAM的產品。

根據弗若斯特沙利文的資料，LPDDR及DDR均屬於DRAM產品，廣泛應用於智能手機、平板電腦、智能電視、可穿戴設備及車載電子等多類智能終端設備。LPDDR具備高頻率、大容量及低功耗的特點，主要應用於對能耗敏感的场景，如智能手機、平板電腦、筆記本電腦及可穿戴設備。DDR因其高帶寬、穩定性強及性價比高優勢，

---

## 業 務

---

主要應用於個人電腦、智能電視及智慧家居設備等場景。未來，隨著AI、邊緣計算的快速普及以及智能應用日益複雜，LPDDR及DDR產品的需求預計將持續增長，這主要受到多元化應用場景中對計算能力、存儲容量及能效更高要求的驅動。

我們開發了先進的多芯片堆疊及封裝技術，包括專有設計的超薄、緊湊、高容量及高密度堆疊解決方案，最多可支持8層堆疊芯片，確保性能穩定可靠，同時大幅降低封裝成本。我們利用全面的內部DRAM測試算法庫，基於自主開發的自動化測試設備(ATE)測試平台及系統級測試(SLT)程序，配合自動化測試設備集成，建立了一套完整的DRAM測試系統。該系統可對LPDDR及DDR產品進行嚴格測試，確保穩定的產品質量及性能，滿足客戶對功能及功耗的要求。詳情請參閱本節「— 我們的技術」。此外，我們自主開發了老化測試系統及設備，能夠支持寬溫範圍可靠性測試。這些系統旨在滿足在惡劣環境中運行的工業控制及汽車電子應用所需的嚴格可靠性標準。於往績記錄期間，我們的LPDDR及DDR產品已通過領先的SoC平台的認證。

於往績記錄期間，我們開始量產最新一代LPDDR5X存儲產品。該產品採用FBGA-315及POP-496封裝技術，支持高達8,533Mbps的數據傳輸速率，並提供4GB至32GB的容量選擇。LPDDR5X具有超高速、高帶寬及低功耗的特點，非常適合高要求的AI模型訓練及實時推理任務，同時還能顯著延長電池壽命、降低發熱量並提高整體系統性能及穩定性。

與消費級產品比較，我們的車規級及工業級LPDDR產品採用高質量晶圓製造，結合專業封裝設計及高可靠性材料，可在極端溫度環境下運行。我們的車規級產品已通過AEC-Q100汽車電子標準認證。

### 基於NAND Flash的產品(eMMC及UFS)

根據弗若斯特沙利文的資料，eMMC及UFS是廣泛應用於智能終端設備的高容量NAND Flash存儲解決方案，用於如智能手機、平板電腦、機頂盒、可穿戴設備及汽車電子等。eMMC憑著緊湊的尺寸及成本優勢，依然廣受歡迎，適用於各種應用。UFS作為eMMC的新一代升級產品，具有明顯提升的數據傳輸速度及能力，主要用於高端智能手機及平板電腦。

## 業 務

截至2025年12月31日，我們提供311個SKU的基於NAND的產品。我們的eMMC產品建立在我們自主開發的專有主控芯片及固件之上。我們在閃存特性及存儲協議方面擁有深厚的專業知識，因此能夠提供針對不同客戶應用場景的定制解決方案。我們的車規級eMMC產品已通過AEC-Q100汽車電子標準的認證，展現出高可靠性及耐用性，以及高達60,000次擦寫循環的耐久性。於往績記錄期間，我們亦成功開發及量產我們自有的UFS主控芯片。根據弗若斯特沙利文的資料，配備我們自主研發控制器的產品是首批進入市場的國產UFS解決方案，其市場性能在同類產品中處於行業領先地位。

### 多芯片封裝嵌入式存儲產品 (eMCP、uMCP及ePOP)

根據弗若斯特沙利文的資料，eMCP、uMCP及ePOP為高度集成的嵌入式存儲產品，專為緊湊型應用場景而設計。此外，eMCP及uMCP基於多芯片封裝技術，將eMMC或UFS與LPDDR集成到單一封裝中，顯著減少PCB佔用空間，並為智能手機及平板電腦等設備提供更緊湊的存儲解決方案。相比uMCP，eMCP因其成本效益而獲廣泛用於智能手機及平板電腦，而性能更高的uMCP主要用於高端產品線。與eMCP不同，ePOP在處理器上直接堆疊eMMC及LPDDR，進一步降低空間需求，特別適用於智能手錶及智能眼鏡等可穿戴設備。

於2019年，我們成功將多芯片封裝嵌入式存儲產品商業化。截至2025年12月31日，我們提供239個SKU的多芯片封裝產品。我們新推出的eMCP產品亦採用自研主控芯片、定制固件及優化算法，有效降低信號干擾，確保數據傳輸穩定高效。搭載我們自研主控芯片的ePOP產品已於2025年第三季投入量產。

### 其他產品

自2021年以來，我們已拓展至固態硬盤的開發、測試及銷售，並於2023年擴展至內存條，作為新產品線的一部分。截至2025年12月31日，我們已提供225個SKU的固態硬盤產品及51個SKU的內存條產品。

我們的固態硬盤產品組合涵蓋主流接口標準，SATA及PCIe，廣泛兼容筆記本電腦、台式機、一體機及工業控制系統。我們的SATA系列產品支持多種規格，包括2.5英寸、mSATA及M.2，採用優質組件製造，並通過嚴格測試驗證，具有出色的耐用性及穩定性。此系列針對工業控制及OEM PC應用進行了專門優化。我們的PCIe系列具備7,400MB／秒的數據傳輸速度，我們的PCIe固態硬盤整合了全方位磨損均衡、閃存

---

## 業 務

---

印射層(FTL)算法、強大的糾錯機制等先進特性及保護設計等先進特性，顯著提高產品的使用壽命及可靠性。憑藉其高速性能及卓越的可靠性，我們的PCIe 4.0固態硬盤已獲高通、AMD及英特爾的AI PC生態系統所採用，並正進行全面的客戶端應用驗證，為AI邊緣計算設備提供穩定高效的存儲解決方案。我們的內存條包括DDR4及DDR5系列，採用優質的DRAM組件。我們的模組採用優化電路設計並按照嚴格的質量標準製造，即使在高頻運行及高內存負載下，亦能確保準確的數據傳輸及穩定的系統性能。

於往績記錄期間，除銷售產品外，我們亦向部分客戶提供技術支持及服務。通過利用可用產能，我們為客戶提供技術及應用支持，幫助其優化運營效率，有利促進更緊密合作關係，並鞏固生態系統中的客戶聯繫。

### 我們的技術

我們的技術創新主要體現在以下幾個方面：

#### a. 閃存主控芯片設計技術

我們在嵌入式閃存領域建立了覆蓋全價值鏈的綜合技術能力，尤其是在閃存主控芯片方面，具備從架構定義、前端電路設計到仿真及驗證的全流程數字電路與模擬電路設計專長。這使我們能夠深刻理解產品需求與設計實現之間的關係，從而顯著提升嵌入式存儲解決方案的性能、可靠性及整體競爭力。我們的閃存主控芯片技術涵蓋跨系統架構設計、模擬電路設計及核心控制器功能的全面內部能力，包括總線架構定義、異構多核CPU協調、基於開源指令集的定制指令擴展以增強性能與降低功耗、電源管理及高速接口設計、兼容主流NAND Flash的閃存訪問及控制模塊開發、用於FTL固件的硬件加速引擎以及低功耗設計策略。憑藉我們對自研主控芯片內部架構及工作原理的深刻理解，我們可以在量產期間更有效地為客戶提供支持，比依賴第三方控制器的供應商更有效地解決主機-NAND兼容性問題，並提供差異化且具有成本競爭力的產品，同時提高技術自主性、供應鏈安全性及整體成本效益。此外，我們具備端到端的控制器芯片研發能力，能夠推出差異化且具高度競爭力的產品。自主研發主控芯片不僅提升了技術自主性，降低對海外技術的依賴，保障了模組研發的供應鏈安全，同時亦有效降低整體成本。

---

## 業 務

---

於往績記錄期間，我們自主研發的eMMC 5.1控制器經過多輪優化迭代，性能始終保持穩定且優異。截至最後實際可行日期，搭載我們自研主控芯片的eMMC存儲產品累計出貨量已達到約1.5億顆。於往績記錄期間，我們的UFS控制器亦已進入量產，配備該控制器的UFS存儲產品已在國內市場推出，標誌著高性能本土化嵌入式存儲解決方案的重要進展。值得注意的是，根據弗若斯特沙利文的資料，我們是中國內地首批量產搭載自研主控的UFS存儲芯片的獨立存儲器廠商，也是中國內地最早量產搭載自研主控的eMCP和ePOP存儲芯片的獨立存儲器廠商。

### b. 存儲顆粒分析技術

於往績記錄期間，我們分別研發了用於DRAM及NAND的顆粒分析技術。根據弗若斯特沙利文的資料，對存儲顆粒進行深入特性分析在優化產品性能並確保在各類應用中的廣泛兼容性擔當重要角色。我們擁有全面的DRAM及NAND顆粒分析能力，包括DRAM存儲陣列、I/O電路及數據路徑分析、關鍵功能表徵及晶圓分析，支持量產測試算法的開發及優化，提升產品質量及可靠性，並通過優化的I/O及數據路徑算法減少測試時間。同時，我們的NAND顆粒分析能力涵蓋閃存命令及功能分析、失效分析模型、性能邊界分析、糾錯及數據恢復策略，以及應用於整個閃存模塊開發及生產週期的先進優化及篩選技術。該等技術以海量高可信度故障模型樣本為基礎，並輔之以自研自動化測試平台，可實現超越傳統方法的先進糾錯及數據恢復，顯著提高可靠性，延長閃存壽命，並確保在不同應用場景下的穩定性能。

### c. 產品設計及先進封裝設計技術

根據弗若斯特沙利文的資料，封裝技術已從單純提供結構保護發展成為半導體存儲器性能的核心驅動力。封裝技術現直接影響存儲芯片的物理穩定性、信號傳輸效率、散熱性能以及集成密度。

通過持續研發，我們已發展了全面的先進封裝設計能力，包括定制化產品設計與仿真、芯片封裝設計與仿真、高密度多芯片堆疊、高可靠性車規級與工業級封裝。我們在高速信號設計與仿真方面的專業能力，確保產品在高頻下穩定運行，同時，差異化封裝技術可提供定制化封裝方案、成本優化設計，以及面向汽車及工業應用的高可靠性封裝。該等技術使我們能夠根據客戶對外形尺寸、性能及能效的要求，提供定

---

## 業 務

---

制化存儲解決方案，並輔之以先進的基板設計優化PCB層堆疊、佈局、佈線及SI/PI性能，從而實現LPDDR5X高達8,533 Mbps的超高數據傳輸速率，以及支持高達八層DRAM架構及超過16GB的LPDDR容量的堆疊設計能力，同時確保工規級與車規級應用的長期可靠性及安全性。

根據弗若斯特沙利文的資料，大規模AI模型的部署需要處理海量數據及高強度計算，對存儲容量、速度及能效的要求較高。我們的LPDDR解決方案具備大容量、高帶寬、超高速及低功耗的特點，已應用於AI訓練及推理任務。我們將持續開發並推出適用於多種應用場景的存儲解決方案，助力各行業AI技術進步，推動新一代生產力的發展。

### d. 固件技術

我們自主研發所有閃存產品的固件，並對核心算法保留完整的知識產權。我們的固件已廣泛應用於消費類、工業、汽車及可穿戴等領域，並可根據客戶需求進行定制化開發，已成為公司核心競爭優勢之一。我們已為UFS及eMMC開發全面的固件功能，涵蓋協議及閃存兼容性、自研FTL算法、多渠道多核管理、高性能糾錯、高級QLC支持、性能優化、掉電保護、以及低功耗管理。該等功能可增強平台兼容性、讀／寫性能、數據安全性及可靠性，延長便攜式設備的電池壽命，支持更廣泛的操作環境，並提高成本效益及市場競爭力。

### e. 高效測試技術

根據弗若斯特沙利文的資料，測試技術在存儲產品的整個生命週期中發揮著關鍵作用，成為產品可靠性的核心保障。我們基於一系列核心技術建立了業界領先的全棧測試能力。

我們已建立高速信號仿真與驗證平台，專解決eMMC、UFS及DRAM等接口的信號完整性與電源完整性挑戰。憑藉先進的仿真能力，我們能夠在產品設計及客戶集成階段提供全面支持，顯著降低設計失敗風險。模擬越接近真實，實際實施時的故障率就越低。通過捕捉真實使用模式並打造更貼近客戶應用的測試環境，我們實現了存儲組件與客戶系統的無縫系統級整合。在設計階段與客戶緊密協作，結合開放的SDK接口以及與SoC平台的合作，我們進一步強化應用能力，助力產品認證並提升產品競爭力。此外，我們自主研發的通用量產測試平台支持多產品、多場景的驗證，覆蓋從研發到量產的全流程需求。憑著高效的測試算法，該平台能夠以低成本精準、高

---

## 業 務

---

覆蓋率篩查不良／失效顆粒，並兼具多樣化測試方法。作為核心基礎設施，該平台不僅提升研發效率、降低測試成本、保障產品質量，還具備長期可擴展性。值得強調的是，平台的硬件、軟件及系統均為自主研發，可靈活擴展以支持多種產品需求。再者，我們自主研發了高精度、高並行度的老化測試平台，能夠模擬極端工作環境，對eMMC、UFS及DRAM等產品進行加速應力老化測試。該技術確保產品滿足嚴格的可靠性標準，提升客戶在量產過程中的成功率、提升良品率並減少售後成本，還助力我們進入汽車電子及高端工業等高門檻市場。

## 研發

### 我們的研發團隊

我們相信，保持一支專注、穩定的研發人才隊伍，對於提升我們的技術及產品組合至關重要。我們已建立一支架構合理、職責分明的研發團隊，與運營戰略緊密結合，以確保我們能夠快速響應瞬息萬變的市場需求。

截至2025年12月31日，我們的技術及研發團隊由在半導體行業研發、設計及／或製造方面擁有豐富經驗的資深專家及工程師組成。我們的研發團隊進行不同產品線的研發，根據每個項目獨特的要求和目標確定研發重點，使我們能夠有效分配資源，並確保我們的創新與市場需求及客戶需要保持一致。於2023年、2024年及2025年，我們的研發開支分別為人民幣56.1百萬元、人民幣77.6百萬元及人民幣97.5百萬元。我們的研發工作具有明確的戰略重點，資源持續投入到與我們業務發展需求及長遠增長目標相契合的重點領域，使我們能夠不斷提升技術能力，增強產品競爭力，並支持我們核心業務的可持續發展。請參閱本文件「財務資料－經營業績主要組成部分說明－研發開支」。

為加強我們的研發能力並獲取特定領域的專業知識，我們會根據具體項目需求，與選定的學術機構開展合作研究。於往績記錄期間，我們就特定主題開展聯合研究項目，該等項目主題不涉及我們的核心技術。

## 業 務

### 我們進行中的研發項目

我們根據市場及生產需求，戰略性地開展研發項目，以支持業務發展。截至2025年12月31日，我們進行中的重點研發項目如下：

項目名稱	目標	現狀
大容量、高速LPDDR5系列產品及測試技術研發 . . . . .	旨在通過新品圓製程、自研基板與先進封裝設計等，開發高速大容量的LPDDR5/5X系列產品，豐富我們的產品線。項目同時開展仿真與測試技術研究，提升設計與質量管控能力，為市場提供高性能、可靠的存儲解決方案。	測試技術應用於生產階段，產品進入小規模試產階段。
AI存儲產品及測試技術研發 . . . . .	旨在基於JEDEC標準開發LPCAMM2與GDDR7產品，擴展我們在AI存儲領域的產品線。項目同時涵蓋PCB設計、軟件與測試算法、SoC平台測試方案及高性能測試設備的研究，提升產品性能與質量，增強我們在AI存儲產品的技術和產品能力。	測試技術進入驗證階段，產品進入測試驗證階段。
多芯片封裝嵌入式存儲產品研發 . . . . .	基於自研eMMC控制器，開發高集成度的eMCP和ePOP芯片。通過封裝設計、基板設計、仿真與測試方法開發，以及多層堆疊和系統級優化，完善我們在嵌入式存儲產品線的佈局，並為高端智能終端提供低功耗、一體化的解決方案。	部分型號在小規模試產階段；部分型號在量產階段
新一代eMMC主控芯片及存儲產品研發 . . . . .	基於第三代eMMC主控芯片技術積累，對主控芯片進行全新技术升級與迭代，大幅度提升芯片性能和兼容性，優化生產成本，研發並量產基於升級主控芯片的eMMC存儲產品。	芯片設計階段

---

## 業 務

---

### 生產

我們的存儲產品生產流程通常包括以下關鍵階段：

**主控芯片設計、流片和製造：**我們的閃存主控芯片由我們自行設計。根據行業慣例，芯片流片工序由合格的第三方進行。該等主控芯片的晶圓製造則由第三方半導體代工廠進行。

**原材料採購：**晶圓製造和後續的存儲顆粒生產由全球及國內主要的存儲產品原廠 (IDM) 進行。我們根據生產預測及客戶需求，從優質供應商採購晶圓、存儲顆粒及其他重要組件。

**產品設計：**我們運用自主研發的產品設計能力，滿足客戶的通用及定制化需求，同時進行端到端規劃並提供技術解決方案，確保整個生產流程的嚴格質量管控。

**封裝：**我們按自身需求進行封裝設計並制定相應的規格方案。遵循行業慣例，我們委託資質優良、經驗豐富的半導體行業第三方服務商，嚴格按照我們的專有標準及工藝要求進行封裝工作，確保產品一致性、可靠性及系統可持續性。

**測試：**測試工作主要在我們的兩個智能製造中心進行，我們充分考慮上游元件特性、中游平台兼容性以及下游客戶應用需求。通過選擇最適合的測試流程，我們確保產品質量及效率的一致性。依託豐富的實踐經驗，我們開展精準且多維度的測試，並通過與中游平台合作夥伴合作及與下游客戶緊密溝通，進一步提升測試準確性、降低錯誤率，並確保測試結果與實際應用契合，確保產品一致性、可靠性及系統兼容性。

我們的生產模式主要以需求為導向，與客戶的要求緊密結合。此涉及多個內部部門之間無縫協調：銷售部門負責生成及確認客戶訂單；研發部門負責制定詳細的技術規格及性能參數；而生產部門負責監督生產計劃、材料採購、外包封裝的供應商管理、內部測試運作及交付追蹤。這種綜合方法使我們能夠保持高標準的產品質量、運營效率及對客戶時限的應對能力。

## 業 務

根據目前的營運模式，我們主要產品類別由封裝起計的估計量產週期如下：

**DRAM產品：**封裝通常需要30-50天，之後進行為期約5-7天的測試，總生產週期為35-57天。

**NAND Flash產品：**封裝通常需要30-50天，之後進行為期約7-10天的測試，總生產週期為37-60天。

**多芯片封裝產品：**封裝通常需要30-50天，之後進行為期約7-10天的測試，總生產週期為37-60天。

### 我們的智能製造中心

於往績記錄期間，我們運營了兩個智能製造中心，一個位於深圳，負責測試基於DRAM的產品，包括我們的主要產品，如DDR4、LPDDR4/4X及LPDDR5；另一個位於中山，專注於測試基於NAND Flash的產品及組合式產品，包括eMMC、UFS、eMCP及ePOP。

我們的深圳智能製造中心配備恒溫恒濕的3,000平方米潔淨車間，具備全自動測試機台及芯片外觀自動檢測機等先進生產設備，以及配套全面的信息化管理系統。該製造中心已獲得ISO9001、ISO14001、ISO45001及ANSI/ESD S20.20認證，配備先進的測試設備，測試項目覆蓋全部協議層，兼容電子器件工程聯合委員會(JEDEC)最新標準，達到行業一流的測試覆蓋率。

我們的中山智能製造中心於2024年10月正式投產，配備恒溫恒濕的2,000平方米潔淨車間，具備高低溫測試系統及芯片外觀自動檢測系統等先進生產設備。製造中心依託自研的寬溫測試平台，進行高性能產品測試篩選，滿足高可靠性應用場景需求，構建起高自動化、高標準的專業測試環境。



— 深圳及中山智能製造中心 —

為提高我們的測試效率，部分設備是由專業生產設備供應商定制。通過與這些供應商的緊密合作，我們確保我們的設備符合我們特定的需求，使我們能夠優化生產流程，提高整體運營效率。

## 業 務

下表載列所示年度我們設施的詳情：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	產量 (千GB)	產能 <sup>(1)</sup> (千GB)	產量 (千GB)	產能 <sup>(1)</sup> (千GB)	產量 (千GB)	產能 <sup>(1)</sup> (千GB)
深圳智能製造中心	165,767	198,336	379,825	452,180	305,527	354,984
		83.6		84.0		86.1
中山智能製造中心 <sup>(3)</sup>	-	-	128,409	217,752	2,066,587	2,644,780
		-		59.0		78.1

附註：

(1) 產能按照容量GB折算。

生產基地產能=Σ(各單條產線產品產能)

單條產線產能=平均每小時產能×每日工作時間×每月工作天數×月份數

(2) 利用率=生產產量／產能

(3) 中山智能製造中心於2024年下半年投產。

於往績記錄期間內，中山智能製造中心的利用率低於深圳智能製造中心，主要是由於中山製造中心於2024年下半年方開始營運。當時，該中心仍處於穩定營運的初期，包括設備校準、增設機械裝置、員工入職以及逐步提升產能。該等因素共同導致該期間的利用率偏低。深圳智能製造中心2025年產能與2024年相比有所減少，主要是由於部分NAND生產設施移至中山智能製造中心。

## 業 務

### 我們的測試流程

我們主要產品的核心測試步驟如下：



\* 此流程對若干產品屬必需，但未必適用於其他產品。

### 我們的外包生產安排

於往績記錄期間，我們有策略地將芯片封裝工序外包給第三方外包合作夥伴。此舉使我們能夠專注於研發與測試流程，提升運營效率，並優化成本管理。通過借助外包合作夥伴的專業能力，我們確保生產流程依然精簡與高效，同時保持高標準的質量與性能。於往績記錄期間，我們委聘的所有外包合作夥伴均為獨立第三方。於2023年、2024年及2025年，我們產生的外包服務成本分別為人民幣111.2百萬元、人民幣161.3百萬元及人民幣223.3百萬元，分別佔同年總銷售成本約5.1%、4.8%及4.9%。

我們在甄選和管理外包生產合作夥伴方面，採取完善的評估與質量保證措施。我們的甄選標準包括合作夥伴的行業經驗、聲譽、技術專長、產品品質與質量控制體系、定價、財務狀況、生產能力以及按時交付的能力。在開展任何外包生產之前，我們的採購部門對每名候選合作夥伴的資質和生產能力進行全面評估。為正式確立質量預期要求，我們與外包合作夥伴訂立產品質量協議。在生產過程中，我們實施多層次監管。我們的工藝質量與質量保證團隊定期派遣人員前往合作夥伴現場，進行駐場監督、抽樣檢測及技術交流，確保生產進行符合我們的標準。我們亦對交付進度進行持續監控。外包加工完成後，成品需經過嚴格的質量檢驗，確保符合我們的內部產品規格及質量標準。此外，我們視需要與外包合作夥伴舉行週會及月會，提供指導與支持，協助其提升產品質量。

請參閱本節「— 質量控制標準」。對於外包合作夥伴提供的任何有缺陷半成品，相關外包合作夥伴需在規定期限內與我們進一步檢驗，且我們有權退回有缺陷的半成品（如需要）。

## 業 務

### 銷售、經銷與營銷

我們採用直銷與經銷相結合的雙重銷售模式。在直銷模式下，我們直接向企業客戶銷售產品。在經銷模式下，我們以買方／賣方基礎向經銷商銷售產品，再由經銷商轉售給最終用戶。下表載列於所示年度按直銷及經銷商銷售劃分的收入貢獻（以絕對金額及佔總收入百分比呈列）：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
直銷 . . . . .	940,664	39.2	1,525,282	41.1	2,775,722	46.9
經銷商						
銷售 . . . . .	1,461,224	60.8	2,188,522	58.9	3,143,761	53.1
總計 . . . . .	<u>2,401,888</u>	<u>100.0</u>	<u>3,713,804</u>	<u>100.0</u>	<u>5,919,483</u>	<u>100.0</u>

### 直銷

於往績記錄期間，我們的直銷客戶主要包括半導體中游及下游市場的領先參與者及品牌擁有人。此類客戶通常對供應鏈標準較高，需經歷產品驗證週期，且採購訂單相對穩定，為我們提供可靠的長期業務來源。我們為各直銷客戶配備專門的銷售與市場人員，他們需具備豐富的存儲產品知識與專業能力，能夠根據客戶的具體需求提供售前諮詢與建議。

於2023年、2024年及2025年，我們的直銷分別佔總收入的39.2%、41.1%及46.9%。我們根據與客戶的總銷售協議所概述條款向他們出售產品。以下為我們與直銷客戶訂立的主要條款概要：(i) **下訂單**：根據客戶需求，在採購訂單中明確產品名稱、數量、規格、採購價格及交付日期；(ii) **付運與交付**：倘需要將訂購產品交付至客戶指定地點，我們將承擔與付運相關的成本和風險。相反，倘客戶安排在我們指定的地點提貨，則客戶將承擔該等成本和風險；(iii) **退貨**：貨物驗收後，我們一般不允許退貨，除非在保固期內出現產品品質問題，這符合業界慣例；(iv) **信貸期**：我們通常要求中小型直接客戶預付款項或貨到付款。我們或會根據選定客戶的信用狀況及過往表現授予信貸期。一般來說，我們向主要直接客戶授出的信貸期由月底至長達三個月不等；(v)

## 業 務

**保固期**：我們根據產品特性及市場慣例提供保固範圍。於往績記錄期間，我們向主要直接客戶提供的保固期介乎一年至五年；及(vi)**期限**：協議期限乃根據與各客戶的合作情況釐定，可按協議所訂明或由雙方相互協定。於往績記錄期間，我們與主要直接客戶的委聘期限介乎三年至長期安排，包括屆滿後可選擇續期的固定年期。

### 經銷商銷售

我們與經銷商合作擴大我們產品的覆蓋範圍及市場能見度。鑒於我們提供的產品種類繁多且量大，以及最終客戶偏好及各地市場情況存在差異，與經銷商合作使我們能夠有效服務不同地區市場。我們的經銷商憑藉其完善的渠道提供全面的售後服務，而我們則根據需要直接向最終用戶提供技術支持。根據弗若斯特沙利文的資料，採用經銷模式符合行業標準慣例。於2023年、2024年及2025年，我們由經銷商產生的銷售額分別佔總收入的60.8%、58.9%及53.1%。

於往績記錄期間，我們實施以下機制來管理和監督我們的經銷安排：(i)**渠道囤貨風險管理**：我們的經銷商通常會根據下游客戶訂單或需求預測採購產品。雖然若干經銷商可能會在行業上升週期進行有限的額外囤貨，但我們認為渠道囤貨的整體風險較低。為進一步降低此風險，我們已建立結構化的渠道存貨監控機制，在該機制下經銷商需提供存貨報告。發現的任何異常情況會透過聯合分析及存貨優化措施及時解決。(ii)**貿易應收款項管理**：我們認為貿易應收款項的可收回性風險有限。我們通常要求中小型經銷商預付款項或貨到付款，並根據信貸評估模型僅向選定的長期經銷商授出信貸。我們每月進行賬齡分析，每週跟進逾期結餘，並採用審慎的會計政策，包括計提預期信貸虧損撥備。(iii)**蠶食風險管理**：我們並無面臨重大的蠶食風險。我們的經銷商管理系統需要客戶渠道登記，且經銷商主要為行業領域明確的穩定企業客戶提供服務，這有助於維持清晰的業務邊界。(iv)**經銷商庫存水平管理**：我們透過定期報告監控經銷商的庫存水平。經銷商通常採用以動銷為導向的採購模式，從事投機性囤貨的動機有限。(v)**銷售目標**：我們不會設定強制性的最低銷售目標。相反，我們根據一套綜合績效框架來評估經銷商，該框架考慮付款及時性、銷售表現及售後合作。

## 業 務

下表載列我們的經銷商於所示日期的總數及於往績記錄期間的變動：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
截至年初.....	74	79	72
— 新增經銷商.....	30	17	29
— 合約屆滿後未獲重續的經銷商..	25	24	17
經銷商淨增加／(減少).....	5	(7)	12
截至年末.....	79	72	84

於往績記錄期間，我們定期審核經銷商的表現，並根據需要對經銷結構進行相應調整。根據弗若斯特沙利文的資料，於2022年至2023年中，中國內地及全球基於DRAM的產品的平均售價大幅下滑，市場需求停滯不前，主要由於2020至2021年疫情推動消費電子產品需求激增後出現週期性需求調整。請參閱本文件「財務資料－經營業績主要組成部分說明－收入－銷量及平均售價」。鑒於下游半導體市場如此波動，我們於2023年調整了經銷結構，淘汰若干表現不佳的經銷商，並委聘具備更強勁多渠道能力的新經銷商。此項重組旨在於充滿挑戰的環境下擴大客戶覆蓋範圍並強化市場渠道。

於往績記錄期間，若干經銷商的合約於相應年度屆滿後未獲重續，主要由於我們經評估經銷商持續表現不佳、影響其正常營運能力的變動、主要人員離職導致客戶關係中斷等因素，以及我們認為可能影響其持續表現的其他因素後決定不再續約。

據我們所深知，於往績記錄期間，我們的所有經銷商均為獨立第三方。我們與經銷商的關係嚴格遵循買方賣方關係。他們是我們的客戶，與下游客戶進行交易時並非代表我們行事。我們對其訂單下達、庫存管理或轉售活動不具管理控制權。經銷商可自行決定向我們下單的時間及數量。我們不允許我們的經銷商委任或委聘任何次級經銷商。我們恪守產品退貨政策，通常不允許經銷商退貨，除非存在產品質量問題，這與行業慣例一致。經銷商銷售收入在產品交付給經銷商且我們收到其確認所有相關條件已滿足後入賬。

---

## 業 務

---

我們與經銷商訂立的銷售協議的主要條款包括：(i)授權：經銷商獲授權向最終客戶出售授批准的產品；(ii)售價：我們提供指導性最終銷售價格，該價格一般於指定期間內有效且可能因應市況而調整；(iii)經銷管理：我們評估經銷商的服務及支持能力，並召開管理層會議以檢討業務表現，而經銷商須在覆蓋前提交建議客戶覆蓋名單以供我們批准；(iv)付款條款：貨物付款根據相關採購訂單訂明的條款支付；(v)交付：經銷商可要求交付至指定地點或從我們的倉庫提貨，損失或損壞風險在交付前由我們承擔，而交付完成後則轉移；(vi)經銷商責任：經銷商須維持專屬銷售團隊，並自費進行營銷及推廣活動、開發最終客戶以及管理物流與配送，並須接受定期資格評估；(vii)保修：我們一般提供一年質量保修；及(viii)期限：協議自簽署起一般為期三年，除非提前終止，屆滿後可經雙方協議重續。

### 定價

我們採取以市場為導向的定價戰略，並密切關注我們所營運市場的發展。我們的策略旨在為客戶提供具有競爭力價格，同時確保業務可持續發展。我們考慮多方面因素，包括產品成本結構、性能特性、應用場景、採購量、市場定位、價格走勢以及整體業務目標。在實務操作中，最終價格一般按具體情況與客戶協商確定。

此外，我們考慮外部市場動態因素，如客戶需求與偏好、市場成熟度及匯率變動。鑒於半導體行業的特性，我們亦建立價格調整機制，以靈活應對市場波動及成本結構變化。

### 營銷團隊及獲客戰略

截至2025年12月31日，我們的銷售與市場團隊由73名專業人員組成，負責推動業務發展、管理客戶關係及覆蓋主要行業領域。

我們的銷售與營銷人員與現有及潛在客戶保持持續溝通、介紹我們現時提供的產品及即將推出的開發計劃。他們定期提供有關產品設計、功能性及技術的詳細資料，以支持客戶決策並促進長期業務合作。除直接的客戶互動外，我們的團隊進行系統性市場研究，以監測技術、定價及客戶偏好的趨勢。他們分析競爭態勢及不斷演變市場狀況，使我們能夠針對性地調整市場戰略，保持應變和競爭力。此外，我們與國內外領先的SoC平台保持深度戰略合作，專注於生態鏈賦能和平台整合。截至2025年12月31日，我們的產品已獲得多家世界領先的SoC平台的《准入供應商名單(AVL)》認證，累計取得合共超過1,400項認證。與平台的協作還使我們更好地了解終端客戶需求，提

---

## 業 務

---

供定制化技術支持，並優化下游設備解決方案，從而有效提升為終端客戶提供服務的能力，同時鞏固我們在整個技術生態中的重要角色。通過把握AI趨勢，我們持續拓展與全球領先SoC平台的驗證合作。此外，我們高度重視品牌建設與產品能見度。為擴大客戶群，特別是在海外市場，我們利用產品口碑，參與展會、行業會議、論壇，以及包括官方網站及社交媒體平台在內的數字渠道。通過將平台合作與這些推廣舉措相結合，我們能夠賦能生態系統客戶，提升市場影響力，並支持長期增長目標。

### 集團內公司間交易

#### 交易安排

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司及其中國內地附屬公司與其香港附屬公司晶存香港進行了若干集團內公司間交易，包括買賣原材料、半成品、成品以及提供若干服務。這些交易按照我們的轉讓定價政策進行，並且遵循所有集團內公司間交易均須按公平基準進行的基本原則。我們的集團內公司間交易主要包括以下各項：

**採購原材料和半成品：**本公司及本公司的附屬公司晶存技術、妙存科技及中山晶存向我們的香港附屬公司晶存香港採購特定原材料及半成品，用以在中國內地生產及銷售。

**銷售成品：**晶存技術、妙存科技及中山晶存向晶存香港銷售其成品。

**提供加工服務：**晶存技術向晶存香港提供加工服務並收取加工服務費。

**提供供應鏈管理服務：**本公司向晶存香港提供供應鏈管理服務。

## 業 務

### 轉讓定價評估

跨境合作的國際組織經濟合作與發展組織（「經合組織」）頒佈了《跨國企業與稅務機關轉讓定價指南》（「經合組織轉讓定價指南」），全球範圍內涉及關聯方交易的相關稅務司法權區普遍遵循該指南。根據經合組織轉讓定價指南，我們的集團內公司間交易應按公平原則進行定價。

### 轉讓定價評估

我們聘請了一家獨立的轉讓定價顧問（「轉讓定價顧問」），其專家來自信譽良好的國際會計師事務所並具備進行轉讓定價評估的資格及專業知識，以根據《經合組織轉讓定價指南》對往績記錄期間的集團內公司間交易進行基準研究。轉讓定價顧問認為，再銷售價格法是評估本集團的轉讓定價安排是否符合公平交易原則的最適用方法。轉讓定價顧問採用地域標準、行業標準、資料完整性標準、研發費用佔比標準和關鍵字搜索標準，進行定量篩選和定性篩選以挑選可比企業。在往績記錄期間各年度，轉讓定價顧問均以可比企業過去三年或兩年半的加權平均毛利率（相關年度之前）的四分位區間作為評估本集團集團內公司間交易利潤水平指標。

根據基準研究結果，晶存香港在往績記錄期間的利潤水平均處於可比企業相關年度加權平均毛利率的四分位區間內。轉讓定價顧問認為，我們的轉讓定價安排符合《經合組織轉讓定價指南》所規定的公平交易原則。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們概無受到地方稅務機關就該等集團內公司間交易進行的任何處罰、調查、查詢或轉讓定價審計。董事認為上述集團內公司間交易符合公平交易原則，且我們於往績記錄期間及直至最後實際可行日期遵守相關轉讓定價法律法規。董事已確認，在轉讓定價顧問的協助下，我們已遵守香港所有稅務申報及合規規定。此外，據中國法律顧問所告知，本公司及其中國附屬公司已根據中國法律正式完成稅務登記。

---

## 業 務

---

董事確認，為確保持續遵守適用的轉讓定價法律法規，我們計劃在第三方稅務顧問的持續支持下定期檢討和監察轉讓定價安排，以確保其符合公平交易原則；為負責有關交易的團隊提供培訓，讓他們及時了解不同司法權區的轉讓定價法律法規；及持續監察我們附屬公司的盈利能力，並在必要時調整定價安排。

### 庫存管理

我們的庫存主要包括原材料、成品、半成品及其他。為有效管理庫存，我們實施了先進的企業資源規劃（「ERP」）系統，定期追蹤並記錄材料與供應品的入庫及出庫。這使我們能夠實時監控庫存，生成庫存變動及表現報告，並最終協助我們維持最佳庫存水平，以滿足客戶需求、盡量減少庫存浪費，並避免持有陳舊庫存。當庫存成本超過其可變現淨值時，我們計提庫存下跌準備。我們的採購通常由已確認的訂單驅動，有助於避免庫存積壓。即使在訂單取消的情況下，大部分材料具有可替代性並可再利用，降低庫存過剩的可能性。此外，如產品開發變動，我們的採購團隊確保在過渡至新材料或元件前，充分利用現有庫存。截至2023年、2024年及2025年12月31日，我們的庫存分別約為人民幣872.9百萬元、人民幣1,161.8百萬元及人民幣4,846.7百萬元，分別佔我們截至同日流動資產總值約58.1%、50.0%及83.2%。我們以訂單導向方式生產成品，而我們有效管理庫存的能力能夠對盈利能力、經營業績及財務狀況造成重大影響。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年、2024年及2025年，我們的存貨周轉天數分別為131天、111天及248天，低於行業平均水平。

### 信息技術

我們利用多個信息技術系統管理我們營運的各個環節，包括但不限於銷售管理、材料採購、生產、質量控制、庫存管理、財務報告及人力資源。在我們的綜合信息系統中，我們設有多個系統，貫穿於我們的業務營運，包括但不限於ERP系統及OA系統。我們的系統在部門間協調以及質量控制方面發揮至關重要的作用。有關詳情，請參閱本節「— 質量控制標準」。我們的信息技術基礎建設的功能性及穩定性對我們的業務運營至關重要。信息技術部門開展系統檢查、數據備份、系統維護及其他活動，以確保關鍵信息技術系統及設施的持續運行。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的信息技術系統並未發生對我們的整體業務運營造成重大不利影響的任何重大故障或全面癱瘓。

## 業 務

### 數據隱私與保護

於往績記錄期間，我們根據適用法律法規，在私人雲平台上收集並儲存與業務營運及發展相關的若干個人資料。所收集的個人資料類型包括：(i)員工的姓名、身分證號碼、手機號碼、郵寄地址（由人力資源部門儲存於個人檔案），以及進出辦公室及辦公大樓所需的指紋及面部識別數據；(ii)辦公室訪客的姓名、身分證號碼及手機號碼（此為辦公大樓物業管理部門所要求）；及(iii)經銷商、客戶及供應商的聯絡資料，例如姓名及手機號碼。

收集及儲存此類個人資料僅用於支持我們的業務營運及商業活動，且收集的數據範圍符合一般商業慣例。所有個人資料均在相關人士自願同意的情況下獲取，我們不會跨境傳輸或向第三方提供該等數據。我們不會出於向外部用戶提供數據儲存或數據營運服務的目的而收集個人資料。截至本文件日期，我們並無透過我們的產品或服務收集、管理、使用、處理或傳輸用戶位置數據、圖像或其他個人資料。我們不向第三方提供或出售個人資料。我們並非網絡平台營運商，亦未被監管機構認定為關鍵信息基礎設施運營者。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未發生因個人資料洩露或濫用而引起的任何糾紛、訴訟或行政處罰。據我們的中國法律顧問告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們在所有重大方面均遵守有關數據隱私、數據安全及網絡安全的所有適用中國法律法規。

我們相信，客戶數據及相關信息的存儲與保護對我們至關重要。我們已實施全面的數據安全與保護體系，為營運、技術及管理提供安全及保護。我們持續從多個維度開發並保護信息安全基礎建設，包括以下幾個方面。首先是數據安全。我們建立一套包括雲端存儲、冗餘政策及備份政策在內的數據安全規範，以防止數據意外丟失。我們亦在解決方案中採用加密技術及數字簽名，以確保數據的真實性、完整性及可追溯性。其次是基礎建設物理安全。我們的信息基礎建設已部署於專業私人雲平台，這些私人雲平台均為中國先進的數據中心，具備物理安全、硬件安全、軟件及網絡安全的專業保護能力。第三是隱私保護。我們對客戶信息及數據實施分級保護，並採用包括訪問授權、加密存儲、加密傳輸及去標識化等隱私政策，以防止個人隱私信息的丟失或洩露。同時，我們建立完整的隱私管理機制，在軟件開發、系統使用、日常檢查及應急處置等不同場景下提供全方位的個人隱私信息保護。

## 業 務

### 質量控制標準

我們高度重視運營各環節的質量控制。我們已建立一套完善的內部質量控制標準，並構建覆蓋採購、研發、生產及銷售流程的成熟質量管理及產品可追溯體系。截至2025年12月31日，我們已取得ISO 9001（質量管理體系）、ISO 45001（職業健康與安全管理體系）及ISO 14000（環境管理體系(EMS)）等認證。我們的質量控制流程高度架構化且標準化，並在每個關鍵階段設有專門人員進行監督質量。我們亦實施一系列預防性措施和系統，以降低產品質量風險。這些措施和系統包括持續的流程監控及先進質量管理工具的應用，如失效模式和效果分析(FMEA)，有助我們主動識別並解決潛在問題。此外，經認證的第三方機構每年進行審計並提供指引，確保我們的系統持續有效且符合最新標準。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的產品未發生重大召回或缺陷問題，亦未收到有關產品質量的任何重大投訴。

### 季節性

儘管我們的主要產品並不受季節性嚴重影響，但中國及國際市場存在若干的季節性模式，部分由於下游市場主要節假日及購物活動的影響。

### COVID-19疫情的影響

於COVID-19期間，我們位於深圳的智能製造中心於2022年根據相關防控措施經歷不足一個月的短期停產，以及因物流服務暫時中斷導致若干交付延遲。這些停產與延遲並未對我們的經營業績造成任何重大不利影響。根據弗若斯特沙利文的資料，COVID-19導致中國半導體行業下游需求大幅增長，由遠距辦公、線上教育及其他數字應用快速擴張所驅動。有關下游需求激增刺激半導體存儲產品需求，並為存儲產品整體行業價格上揚做出貢獻。因此，我們的產品需求亦增長，令客戶訂單量增加，並推動期內產品平均售價上揚。

### 我們的客戶

我們的主要客戶包括半導體行業下游分部的行業領先企業及品牌擁有人，以及經銷商。於2023年、2024年及2025年，我們於往績記錄期間各年的五大客戶對同年總收入的貢獻分別為45.0%、49.3%及30.2%。此外，於往績記錄期間各年，最大單一客戶對同年總收入的貢獻分別為21.0%、14.8%及9.7%。下表載列於往績記錄期間我們的五大客戶詳情。

## 業 務

### 截至2023年12月31日止年度

客戶	主要業務	所供產品	自以下年度起與業務關係	收入金額 (人民幣千元)	佔總收入%	信用條款*	付款方法	註冊資本
客戶A	元器件營銷	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2020年	504,375	21.0%	預付款/於交付時到期支付	電匯	~人民幣10億元
客戶B	ICT行業產品和解決方案設計、開發、生產、銷售、服務	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2021年	231,293	9.7%	自月底起60天到期支付	電匯	~人民幣48億元
客戶D	元器件營銷	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2021年	174,690	7.3%	預付款/於月底到期支付	電匯	~人民幣4億元
客戶F	元器件營銷	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2023年	98,688	4.1%	預付款/於交付時到期支付	電匯	~人民幣3億元
客戶G	智能手機等移動終端產品研發、生產、銷售	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2019年	71,879	3.0%	於交付後30天到期支付	電匯	~人民幣80億元
總計				1,081,755	45.0%			

\* 基於每位客戶的信用記錄及每項訂單的詳情，我們將按個案評估是否為若干訂單延長付款期。

### 截至2024年12月31日止年度

客戶	主要業務	所供產品	自以下年度起與業務關係	收入金額 (人民幣千元)	佔總收入%	信用條款*	付款方法	註冊資本
客戶A	元器件營銷	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2020年	549,242	14.8%	預付款/於交付時到期支付	電匯	~人民幣10億元
客戶B	ICT行業產品和解決方案設計、開發、生產、銷售、服務	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2021年	427,615	11.5%	自月底起60天到期支付	電匯	~人民幣48億元
客戶H	元器件營銷	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2024年	424,321	11.4%	於交付後60天到期支付	電匯	~10,000萬元
客戶D	元器件營銷	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2021年	301,153	8.1%	預付款/於交付時到期支付	電匯	~人民幣4億元
客戶G	智能手機等移動終端產品研發、生產、銷售	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2019年	131,279	3.5%	於交付後30天到期支付	電匯	~人民幣80億元
總計				1,833,810	49.3%			

\* 基於每位客戶的信用記錄及每項訂單的詳情，我們將按個案評估是否為若干訂單延長付款期。

### 截至2025年12月31日止年度

客戶	主要業務	所供產品	自以下年度起與業務關係	收入金額 (人民幣千元)	佔總收入%	信用條款*	付款方法	註冊資本
客戶A	元器件營銷	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2020年	575,971	9.7%	預付款/於交付時到期支付	電匯	~人民幣10億元
客戶B	信息通信技術(ICT)行業產品和解決方案設計、開發、生產、銷售、服務	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2021年	553,651	9.4%	自月底起60天到期支付	電匯	~人民幣48億元
客戶I	半導體顯示、智能終端產品研發、生產、銷售、服務	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2021年	238,446	4.0%	自月底起60天到期支付	電匯	~人民幣208億元
客戶D	元器件營銷	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2021年	222,152	3.8%	預付款/於交付時到期支付	電匯	~人民幣4億元
客戶H	元器件營銷	基於DRAM及基於NAND Flash的產品	2024年	195,340	3.5%	於交付後60天到期支付	電匯	~10,000萬元
總計				1,785,560	30.2%			

\* 基於每位客戶的信用記錄及每項訂單的詳情，我們將按個案評估是否為若干訂單延長付款期。

---

## 業 務

---

截至最後實際可行日期，董事、彼等的緊密聯繫人或就董事所深知擁有本公司已發行股本5%以上的任何股東概無於我們於往績記錄期間各年的五大客戶中擁有任何權益。就董事所深知，我們於往績記錄期間各年的五大客戶均為獨立第三方。

### 第三方付款

於往績記錄期間，我們的若干客戶根據相應買賣合同通過屬於合同對手方以外一方的賬戶向本公司及我們的附屬公司結清款項。

該等安排主要分為以下兩類：

#### 通過客戶的供應鏈服務供應商付款

於往績記錄期間，我們部分客戶通過屬於第三方供應鏈服務供應商的賬戶（個別或統稱為「**供應鏈付款客戶**」）向本公司及我們的附屬公司結清款項。第三方供應鏈服務供應商主要為隸屬於擁有其他業務線的大型企業集團但提供專屬供應鏈管理服務的實體。該等供應商在物流、庫存管理、採購協調及其他營運職能方面提供協助，使供應鏈付款客戶能夠維持精簡且反應迅速的供應鏈。

於2023年、2024年及2025年，供應鏈服務供應商向我們支付的總額分別為人民幣99.2百萬元、人民幣215.9百萬元及人民幣197.3百萬元，分別佔我們收入的約4.1%、5.8%及3.3%。於往績記錄期間，概無個別供應鏈付款客戶為我們的收入作出重大貢獻。截至2025年4月1日，我們已與所有活躍的供應鏈服務供應商及供應鏈付款客戶訂立三方協議，確保雙方均為與我們達成協議的直接交易對手。因此，此類第三方付款安排自此已停止使用。此外，任何擬使用供應鏈付款的客戶須於進行任何交易前簽署相關三方協議。

我們的董事確認，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，(i)我們並無主動提出任何有關付款安排；(ii)我們並無向任何供應鏈付款客戶提供任何折扣、佣金、回扣或其他利益以促成或激勵該等付款安排；及(iii)我們與供應鏈付款客戶訂立的協議的定價及付款條款與並無參與供應鏈付款安排的客戶所訂立的協議一致。

## 業 務

根據弗若斯特沙利文的資料，半導體行業的客戶透過供應鏈服務供應商結清其交易並不罕見。供應鏈付款客戶使用供應鏈付款安排有兩個主要原因。首先，部分客戶傾向委聘第三方供應鏈服務供應商辦理就向我們採購產品的交付與轉運報關、清關及相關服務。為方便起見，該等部分客戶亦通過其第三方供應鏈服務供應商的賬戶與我們結清交易。其次，我們通常要求客戶就產品作出預付款。然而，該等第三方供應鏈服務供應商可根據客戶之間的條款及條件，就通過其賬戶與我們結清的款項向其客戶提供信貸期。因此，出於商業原因，部分客戶傾向通過其第三方供應鏈服務供應商的賬戶與我們結清其交易。

### 通過其他第三方付款

於往績記錄期間，我們部分客戶（主要為中小型企業）通過供應鏈付款供應商以外的第三方的賬戶（個別或統稱為「其他第三方付款客戶」）向本公司結清款項。此主要是由於客戶考慮付款便利性。在大多數情況下，第三方付款人為該等客戶的業務夥伴。於2023年、2024年及2025年，該付款安排的付款總額分別為人民幣5.0百萬元、人民幣6.8百萬元及人民幣2.5百萬元，分別佔我們收入的約0.2%、0.2%及0.0%。於往績記錄期間，概無個別其他第三方付款客戶為我們的收入作出重大貢獻。

我們的董事確認，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，(i)我們並無主動提出任何有關付款安排；(ii)我們並無向任何該等客戶提供任何折扣、佣金、回扣或其他利益以促成或激勵該等付款安排；及(iii)我們訂立的該安排協議的定價及付款條款與並無參與供應鏈付款安排及其他第三方付款安排的客戶的協議一致。

### 影響

鑒於：(a)本公司已從供應鏈付款客戶和其他第三方付款客戶及其指定付款方（於往績記錄期間佔有關付款安排所產生收入的大部分）取得確認，確認本公司與該等往績記錄期間交易相關的所有該等付款安排均基於真實、合法的背景及準確的交易金額，受託付款方用於向本公司付款的資金來源完全合法、正當，該等安排不涉及任何洗錢、恐怖主義、貪污賄賂、走私、逃稅騙稅、金融詐騙等違法犯罪所得，不存在通過委託付款安排逃稅或不當獲取稅收利益的行為，且相關主體在任何情況下均無權就相關委託付款提出退款、賠償、追索或任何其他形式的權利主張；及(b)於往績記錄期

---

## 業 務

---

間及截至最後實際可行日期，本公司並未被要求退款，且並不存在任何實際或潛在的爭議或分歧涉及任何供應鏈付款及其他第三方付款安排；中國法律顧問認為，(i)本公司因供應鏈付款安排及其他第三方付款安排並未違反中國現行法律或法規的任何強制性規定；及(ii)本公司及其附屬公司被認定為協助洗錢或偷逃稅款的風險較小，因供應鏈付款及其他第三方付款安排而被追索、被要求退款或者賠償的風險亦較小。

誠如本公司所確認，(i)供應鏈付款安排及其他第三方付款安排由相關客戶發起，而非由本公司計劃，以規避適用的中國稅法或其他法規。先前根據該安排收到的所有客戶款項均已按照本公司的會計程序及政策正式入賬；(ii)於往績記錄期間，本公司並無因有關付款安排而被識別為違反任何適用稅法；及(iii)我們僅接受第三方付款人通過持牌銀行的匯款付款，以確保有關資金符合該等銀行實施的反洗錢規定；及(iv)於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，本公司概無就供應鏈付款安排及其他第三方付款安排涉及任何糾紛或遭受有關政府機關的行政處罰。

根據中國相關法律法規及監管要求，包括《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反洗錢法》及《中華人民共和國反恐怖主義法》，洗錢包括掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪和其他犯罪活動所得收益來源、性質的行為，以及自該等活動產生的收益；資助恐怖主義包括為恐怖活動組織、恐怖活動人員、實施恐怖活動或者恐怖活動培訓提供資金的行為。

考慮到主要相關各方已確認並承諾，於往績記錄期間所有第三方付款安排均基於真實合法的背景及準確的交易金額，且並無違反任何法律及法規的強制性或禁止性條文，我們的中國法律顧問認為，本公司及其附屬公司被視為協助洗錢或逃稅的風

---

## 業 務

---

險較小，而本公司及其附屬公司因該等第三方付款安排而面臨追索、被要求退款或承擔賠償責任的風險亦較小。

### 內部控制措施

為降低與上述付款安排有關的風險及防止日後再次發生類似情況，我們已實施內部控制措施。對於其他第三方付款客戶，我們已於2025年第一季度完成涉及該款項的最後一筆交易，並終止任何現有的其他第三方付款安排，且自2025年7月起，我們已強化並實施禁止任何額外其他第三方付款安排的政策；有關禁止並未及預期日後不會對本公司造成任何重大不利影響。對於供應鏈付款客戶，我們要求彼等向我們提供相關資料，包括第三方付款人的身份，及確認相關客戶將其在原協議下的付款責任轉移至各第三方付款人，而該等第三方付款人承諾根據相同條款直接向我們付款，或該第三方付款人與客戶就有關付款承擔連帶責任；且在第三方付款人據此將款項存入我們的賬戶後，我們的財務部門將根據交易資料將款項匹配至相應客戶賬戶。

本公司已制定內部控制措施以維護本公司財務及會計資料的完整性以及防止欺詐及洗錢活動。我們已建立財務管理系統與資料系統賬戶、密碼及權限管理系統，以規管財務報告過程及財務資料的完整性。有關政策由管理層批准並傳閱予相關員工以供執行；及我們已制定行為守則，其中載列所有員工應遵守的規則或政策。

我們將定期對上述內部控制措施的有效性進行檢討，發現異常及失常時將及時處理。我們的法律及財務部門負責提供詳細的審閱結果並定期向管理層報告有關結果。我們的董事認為，上述內部控制措施已有效及充分防範供應鏈付款的相關風險，且我們的董事日後將監督上述內部控制措施的成效。

### 我們的供應商

我們的主要供應商主要包括原材料供應商，如存儲晶圓及芯片顆粒供應商以及封裝服務供應商。於2023年、2024年及2025年，我們於往績記錄期間各年的五大供應商分別佔我們同年總採購額的72.5%、76.0%及82.0%。此外，我們於往績記錄期間各年的單一最大供應商分別佔我們於同一年總採購額的46.5%、53.3%及68.5%。

---

## 業 務

---

根據弗若斯特沙利文的資料，存儲產品行業的DRAM及NAND晶圓供應商高度集中，導致眾多存儲產品製造商依賴數量有限的供應商。我們自2019年起與供應商A維持長期合作關係，供應商A是全球存儲產品行業領先參與者的主要供應商。在往績記錄期間，我們與供應商A訂立長期協議，因此我們面臨一定程度的供應商集中風險。詳情請參閱本文件「風險因素－我們集中向若干主要供應商採購主要原材料及零部件。倘供應中斷或我們與該等供應商的關係發生變化，可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響」。2024年及2025年向供應商A的採購比例上升，主要是由於我們與供應商A的合作關係更加緊密，這使我們得以在存儲產品行業面臨全球性原料短缺的情況下，確保原料供應並滿足下游需求。由於我們與供應商A維持著穩定且密切的合作關係，因此主要直接向其採購，無需透過中間商。因此，供應商集中度的提高反映了我們與供應商A合作關係的穩定性。此外，全球市場上尚有其他供應商可供選擇，而我們持續與供應商A合作，主要源於商業考量。倘若供應商A的供貨出現任何中斷，我們將能及時以現行市場價格向其他供應商採購所需材料。多年來，我們已逐步拓展供應商基礎，並積極尋求潛在供應商，以抵禦市場波動及供應商集中度風險。截至最後實際可行日期，為將我們的供應商基礎多元化，我們已與其他主要存儲晶圓供應商訂立合作協議，並減輕未來對供應商A的依賴。此外，隨著全球及國內存儲行業均不斷發展，我們預期將有越來越多供應商，讓我們能進一步加強並實現供應鏈多元化。

下表載列我們於往績記錄期間的五大供應商詳情。

## 業 務

### 截至2023年12月31日止年度

供應商	主要業務	所採購產品/服務	自以下年度起採購總額	採購總額 (人民幣千元)	佔總採購總額%	信託條款	備付方法	註冊資本
供應商A	存儲芯片研發、生產、銷售	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2019年	1,091,393	46.5%	預付款	電匯	~11億美元
供應商F	芯片貿易	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2022年	257,076	11.0%	於交付後30天到期支付	電匯	~1百萬港元
供應商G	芯片貿易	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2019年	158,697	6.8%	預付款	電匯	~10,000港元
供應商L	芯片貿易	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2022年	109,050	4.6%	自月底起30天到期支付	電匯	~人民幣10億元
供應商I	芯片封裝	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2021年	84,288	3.6%	自月底起60天到期支付	電匯	~人民幣30億元
總計				1,700,704	72.5%			

### 截至2024年12月31日止年度

供應商	主要業務	所採購產品/服務	自以下年度起採購總額	採購總額 (人民幣千元)	佔總採購總額%	信託條款	備付方法	註冊資本
供應商A	存儲芯片研發、生產、銷售	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2019年	1,942,035	53.3%	預付款	電匯	~11億美元
供應商F	芯片貿易	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2022年	285,765	7.8%	於交付後30天到期支付	電匯	~1百萬港元
供應商L	芯片貿易	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2022年	277,872	7.6%	自月底起40天到期支付	電匯	~人民幣8億元
供應商G	芯片貿易	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2019年	152,191	4.2%	預付款	電匯	~10,000港元
供應商I	芯片貿易	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2019年	113,013	3.1%	預付款	電匯	~20萬港元
總計				2,770,876	76.0%			

### 截至2025年12月31日止年度

供應商	主要業務	所採購產品/服務	自以下年度起採購總額	採購總額 (人民幣千元)	佔總採購總額%	信託條款	備付方法	註冊資本
供應商A	存儲芯片研發、生產、銷售	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2019年	5,671,145	68.5%	預付款	電匯	~11億美元
供應商J	芯片貿易	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2019年	404,544	4.9%	預付款	電匯	~20萬港元
供應商L	芯片貿易	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2022年	278,714	3.4%	自月底起40天到期支付	電匯	~人民幣10億元
供應商G	芯片貿易	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2019年	229,030	2.8%	預付款	電匯	~10,000港元
供應商M*	芯片貿易	DRAM、NAND晶圓及存儲模塊	2023年	207,174	2.5%	自月底起30天到期支付	電匯	~人民幣5百萬元+~10,000港元
總計				6,790,607	82.0%			

\* 供應商M包括公司X及公司Y兩家實體，彼等均自由同一控股股東（獨立第三方個人）控制。註冊資本數字分別指公司X及公司Y的註冊資本。

---

## 業 務

---

截至最後實際可行日期，董事、彼等的緊密聯繫人或就董事所深知擁有本公司已發行股本5%以上的任何股東概無於我們於往績記錄期間各年的五大供應商中擁有任何權益。就董事所深知，我們於往績記錄期間各年的五大供應商均為獨立第三方。

### 客戶及供應商重疊

供應商M包括公司X及公司Y兩家實體，彼等均由同一控股股東（獨立第三方個人）控制。公司X及公司Y均為從事半導體行業的貿易公司。於往績記錄期間，我們在日常業務過程中向公司X及公司Y採購DRAM、NAND晶圓及存儲顆粒，同時向公司Y銷售基於DRAM及基於NAND Flash的產品，相關採購與銷售交易相互獨立。於2023年、2024年及2025年，我們向公司X及公司Y的採購額分別為零、人民幣3.8百萬元及人民幣207.2百萬元，佔相關年度採購總額分別為零、0.1%及2.5%。同年，我們自公司Y產生的收入分別為人民幣0.1百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣19.8百萬元，佔相關年度總收入均低於0.5%。

與公司X及公司Y的條款均按公平基準獨立磋商，該等銷售及採購互不關聯且互不為條件。此外，上述與本公司的交易條款符合市場慣例，且與其他客戶及供應商的交易條款基本一致。除已披露者外，據我們所知，於往績記錄期間各年度，我們的主要客戶均非我們的供應商，反之亦然。

### 環境、社會及管治（「ESG」）

我們致力於ESG建設，將可持續發展原則深度融入集團的日常運營和長期戰略中，以支持企業可持續發展。

#### ESG管治架構

基於對可持續發展戰略的規劃，我們正積極推進將ESG理念融入集團的日常管理與運營，並計劃逐步完善自上而下的ESG治理架構，明確各層級、各部門的工作職責，為ESG工作開展提供組織保障，充分保護股東的合法權益。董事長作為集團ESG事務的最高負責人與決策者，負責對ESG重大議題、執行目標、信息披露及對外報告等事項進行審議、審批與決策，並統籌評估和管理ESG相關的影響、風險與機遇。

---

## 業 務

---

我們設立了ESG事務部，同時下設ESG執行組，全面覆蓋ESG工作流程，完善資源協調，進一步確保目標落實。

### 環境指標與管理

我們已建立並持續維護ISO14001管理體系，實現了環境、能源、職業健康安全與質量管理的國際標準化。為強化ESG管理，我們設置了《環境與職業健康安全目標指標及管理方案控制程序》，每年制訂環境及職業健康安全目標、指標和管理方案，並按目標指標採取相關活動措施。能源與環境管理重點包括實施能源資源控制程序。

### 排放物

我們優先開展生產經營過程中的排放物管理，設立了《消耗臭氧層物質控制程序》及《排放源清單識別》，減少消耗臭氧層物質，保護臭氧層。由於我們於往績記錄期間僅配備不到五台商用車，因此在廢氣排放方面的影響較少，廢水排放僅限於辦公生活污水，不涉及工業廢水處理。

*廢棄物管理政策與實踐：*我們的產品不涉及再利用，而我們的工廠作為測試設施不涉及有害廢水或其他形式的排放及利用。我們實施《廢棄物控制程序》，對廢棄物自分類、存放、清運至處置的全流程管理作出要求。我們實行分類存放制度，並設立專用容器與存放區域。我們持續推動生產工藝優化與資源節約利用，從源頭減少廢棄物產生。通過定期組織員工環保培訓，強化廢棄物管理意識與操作規範性。

### 資源消耗

我們嚴格遵循國家規定，將節能與節水審查納入業務運營與投資決策流程，支持國家「雙碳」目標，促進資源的可持續利用。我們已實施一項資源管理政策，涵蓋能源、水及原材料的高效使用與節約措施。依據《能源資源管理程序》，我們在年度能源與環境管理計劃中設定清晰的節能目標、實施措施、職責、時間表及預算分配。

## 業 務

**電能消耗管理：**我們透過整合多方面的控制措施來管理電能消耗。在設備方面，我們實行責任制，空調溫度夏季控制在26°C以上，推廣節能燈具，嚴格執行人走斷電。在辦公室，我們採取定時開關制度、鼓勵無紙化辦公及雙面打印，減少電梯使用頻次。在生產領域，我們通過集中生產安排最小化設備啟停次數，選用高效機電設備以降低單位能耗。

**水資源消耗管理：**我們計劃持續優化用水流程，進一步強化設施維護與監管。為此，在所有用水點設置節水標識，建立定期巡檢機制，及時修復洩漏。此外，我們發佈了全員節水倡議，加強耗水工序管控。

為踐行綠色發展責任，我們嚴格控制包裝材料使用，並持續監測水電消耗情況，建立清晰的績效管控目標，控制資源消耗。

2023至2025年期間，本集團資源消耗的具體情況如下：

資源分類	單位	2023年	2024年	2025年
電能 .....	兆瓦時	2,387.4	4,179.2	7,826.4
水資源 .....	萬噸	1.1	1.3	1.8

我們的資源消耗於2024年及2025年均有所增加，主要是由於我們中山智能製造中心於2024年開展運營並於2025年擴大運營。我們將積極履行ESG責任，努力降低單位產品消耗，推進經營與綠色可持續的協同發展。

### 碳管理

我們優先進行碳排放管理，致力於通過系統性的減排行動推動環境績效的提升。為實現有效的排放控制，我們專注於源頭控制及過程管理措施，特別是在消耗臭氧層物質(ODS)方面。有關措施包括優先使用「無氯氟化碳」的產品以減少ODS的使用、執行冷卻劑回收程序以防止洩漏，以及實施洩漏檢測與修復機制。我們亦通過清除CFC及HCFC類製冷劑來確保妥善處置廢舊電器，禁止使用含甲基溴的殺蟲劑，並聯合相關

## 業 務

部門推廣替代品。此外，我們加強製冷維護工作，妥善處理回收的製冷劑，杜絕廢氣排放，並開展例行檢查。下表載列本集團於所示年度的具體碳排放：

分類	單位	2023年	2024年	2025年
範圍一 .....	公噸二氧 化碳當量	16.9	18.2	23.4
範圍二 .....	公噸二氧 化碳當量	1,361.5	2,383.4	4,463.4
範圍三 .....	公噸二氧 化碳當量	148.0	105.8	99.1

附註：範圍三包括耗水量及包裝材料。2024年，我們優化出貨所用的包裝材料。每個紙箱現可容納更多顆粒，從而減少紙箱材料消耗（此為範圍三排放的主要來源），進而降低整體範圍三排放量。

我們將持續實施環境管理策略，通過制定年度能源減排目標並執行系統化的監測機制，確保環境影響持續降低。於往績記錄期間，噪聲監測結果穩定符合國家標準，未來將進一步優化減排措施，提升環境績效水平。

### 氣候相關風險與機遇識別

為應對氣候相關重要議題的影響，我們制定了《ODS控制程序》，通過定期識別與評估ODS排放源，並實施相應控制措施，以管理其潛在氣候影響。經評估，我們的業務運營未受到氣候相關重大問題的直接影響，運營環境穩定，氣候風險處於可控範圍。同時，我們建立了系統化的氣候風險管理機制，依據《組織環境與風險機遇識別評價表》對氣候風險進行動態識別與評估，並據此制定及實施針對性防控措施，持續提升集團對氣候變化的適應能力，保障長期穩健發展。

### 社會指標與管理

在企業發展進程中，我們始終將社會責任視為核心發展理念與行動自覺。為確保全面遵守運營所涉及的各项法律法規，我們已制定《法律法規及其它要求合規性評價表》，並通過該表對相關內容進行合規性核查，以確認其符合要求。

## 業 務

**員工僱傭情況：**我們禁止任何因種族、社會階級、國籍、宗教、殘疾、性別、性取向、年齡、具體能力及政治關係引發的歧視行為。為此我們設立了《反對歧視管理規定》，規定公司內外部團體、個人均有權對集團行為進行監督或投訴。截至2025年12月31日，我們擁有247名女性員工及257名男性員工。於往績記錄期間，我們嚴格遵守相關法律法規，確保未發生任何形式的強制勞動行為，亦未僱傭任何未達到法定最低就業年齡標準的未成年人從事勞動活動，即未發生強制勞工和僱傭童工的情況。

### 職業安全建設

我們通過了ISO 9001及ISO 45001認證，針對工作相關的可能危害和發生危險情況的過程，我們設立了《危險源辨識與評價管理程序》、《重大職業健康安全危害與風險源控制一覽表》。我們堅持火災爆炸事故零發生的安全管理目標。於往績記錄期間，未發生任何因工作原因導致的員工死亡事件。為確保職業健康安全管理有效推進，並落實各級人員的職業健康安全管理責任，我們設立了職業健康安全管理委員會。我們每季度至少召開一次安全生產專題會議，研究審議安全生產重大事項，協調集團內各相關機構的安全生產工作。

**員工發展與培訓：**為全面提升員工綜合素質和專業技能，推動組織績效與經營業績提升，我們制定了《培訓管理制度》，設置了公司級培訓、部門級培訓、專項培訓，以及提升培訓等，為全體員工提供全面的發展路徑。我們設立了《績效考核及激勵方案》，明確了績效考核規則、季度獎金評定規則、績效反饋、績效申訴等相關標準及流程。我們設立了《引進激勵優秀人才管理制度》，一級響應人才引進工作，充分利用內部資源挖掘優秀人才，對內部引薦優秀人才的員工頒發伯樂獎，並建立了自己的內外人才地圖及人才庫。

**可持續供應鏈：**我們始終將可持續發展理念融入供應鏈管理，通過科學的供應商篩選標準、嚴格的評分體系和動態化的日常管理機制，構建綠色、高效、責任共擔的供應鏈生態系統，助力集團長期可持續發展。通過制定《採購作業管理程序》，我們對

---

## 業 務

---

所有採購相關業務的物資採購流程進行了規範，提高採購效率，並明確各崗位職責，有效加強與各部門間的配合，降低了採購成本。

**產品責任：**我們通過嚴格的產品管理、卓越的創新設計與研發、國際化戰略合作以及知識產權保護，全面履行產品責任。我們遵循了《責任商業聯盟行為準則》，承諾建立、實施和有效持續改進勞工、安全、環境、道德體系，識別並降低相關的經營風險，持續推動並使該體系符合準則與客戶要求。於往績記錄期間，我們未發生重大產品召回事件。我們目前積極遵守有關健康及安全、廣告、標籤及／或所提供產品／服務的私隱事宜的相關法律，未發生違法行為。

**社區與公益：**我們積極踐行企業社會責任。2019年，在福田區慈善會的領導下，我們成立了晶存愛心公益基金，先後向河源市和平縣馬塘小學捐贈助學物資；向武漢同濟醫院捐贈醫療物資；向湖南衡陽捐建特殊兒童康復訓練功能室；向福田區養老機構捐贈清涼飲料和免洗抑菌噴霧。此外，我們組織員工為福田區園嶺八角樓託養中心提供愛心服務，並向香港火災援助基金捐款。

**反貪腐：**我們設立了《反舞弊管理實施細則》，明確了內部審查、預防措施、舉報程序、實施和監察等全流程，針對全體高管及中基層員工開展反貪腐專項培訓，對供應商及合作夥伴實施反貪污盡職調查，並持續開展重點業務部門的貪污風險排查，打造廉潔、勤勉、敬業的良好風氣。

### 工作場所安全、生產安全及職業健康

我們遵守規管加工廠房安全運營的相關中國法律及法規，包括《中華人民共和國安全生產法》。我們在生產基地建立嚴格的檢查機制，以確保遵守所有法規並為員工提供安全的工作環境。我們嚴格遵循安全防護目標，落實相關法律、法規、規章及標準對安全運營的要求。我們已制定涵蓋消防安全、操作安全、倉儲安全、工傷以及緊急

---

## 業 務

---

情況應變及疏散程序的一系列安全指引。我們亦就所有生產線實施先進的安全措施，並為僱員配備適當且必要的防護裝備。我們全面落實安全生產責任制，並開展各方面安全生產工作。

### 知識產權

我們認為知識產權對我們的業務運營至關重要，且我們於知識產權發展及保護方面投入大量時間及資源。截至2025年12月31日，我們持有(i)中國278項已授出專利，包括251項發明專利，(ii)28項中國計算機軟件著作權，(iii)中國32項商標及一項海外商標，(iv)中國六項登記集成電路佈圖設計，(v)中國五項域名，及(vi)中國一項設計版權。有關詳情，請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－有關本公司業務的進一步資料－2. 知識產權」。

除提出商標及專利註冊申請外，我們實施一套全面的措施來保護我們的知識產權。我們的主要措施包括：(i)委派專人指導、管理、監督及監察有關知識產權的日常工作；(ii)適時啟動知識產權的註冊、備案及申請程序；(iii)積極追蹤我們的知識產權狀況，並在發現與我們的知識產權存在任何潛在衝突時及時採取行動；及(iv)在我們訂立的所有僱傭合約及商業合約中載明有關保護知識產權的相關權利及義務。

截至最後實際可行日期，除本文件另行披露外，我們並無因侵犯第三方的商標、許可及其他知識產權而遭受任何重大爭議或索償。

### 出口管制及貿易限制的影響

#### 美國出口管制的影響

BIS維持各種須遵守加強出口管制的實體及個人清單。其中，實體清單對指定的外國人士(包括公司、研究機構、政府和私人組織以及個人)施加貿易限制。被列入清單的各方不得接觸某些美國原產物項，例如貨物、軟件和技術，以及包含受管制美國原產成分的物項及源自特定美國技術或設備的外國製造產品。我們先前的兩名客戶已被列入實體清單，其中一名客戶被指定為註腳3(「**實體清單客戶**」)。儘管如此，考慮到(i)我們購買的物項並不包含須遵守EAR的任何美國原產組件或技術；(ii)我們銷售的內存產品於中國製造，且並無包含任何受管制美國原產商品或與受管制美國原產軟件捆

---

## 業 務

---

綁銷售；(iii)與實體清單上所有指定實體的交易已於其列入清單之前完成且並無發生後續交易，我們的國際制裁法律顧問認為與實體清單客戶的交易毋須遵守EAR。

### 國際制裁及貿易限制的影響

於往績記錄期間，我們向數個海外國家及地區銷售內存產品。概無國家及地區屬於被制裁指引項下的被制裁國家，且概無任何交易對手被指定為被制裁目標，亦無任何交易對手位於被制裁國家、於被制裁國家註冊成立、組織或居住。

### 美國制裁

我們的一名客戶及兩名供應商被美國國防部（「**國防部**」）列入《2021財年威廉·麥克·索恩伯里國防授權法》第1260H條項下被認定為在美國經營的中國軍事企業的實體清單（「**第1260H條清單**」），亦稱為「中國軍事企業清單」（「**CMC清單**」）。CMC清單上列出的實體可能面臨禁止簽訂美國國防合約及禁止提供遊說服務的影響。由於我們與美國國防部並無貨物、服務或技術的聯繫或合約，我們的國際制裁法律顧問告知我們，與CMC清單相關的限制不適用於我們與指定實體之間的交易。

### 其他國際制裁

於往績記錄期間，由於我們並無與受聯合國、歐盟、英國或澳洲制裁的任何人士進行業務往來，我們的國際制裁法律顧問告知我們，我們的業務活動並無涉及聯合國、歐盟、英國或澳洲所採取的限制性措施。

### 關稅政策的影響

董事確認，基於本公司的商業模式及供應鏈結構，關稅政策不會對本公司的營運產生重大影響。就美國關稅政策而言，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無向美國出口產品。因此，美國政府實施的關稅措施對我們的業務、財務狀況或經營業績並無直接影響。就歐盟關稅政策而言，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，儘管我們向歐盟出口少量產品，但歐盟於同期並未對中國半導體產品加徵關稅。因此，我們的業務、財務狀況及經營業績並未受到歐盟關稅措施的重大影響。就中國進口關稅政策而言，在原材料採購方面，於往績記錄期間及直至最後實際可行日

## 業 務

期，我們並無採購源自美國的晶圓或其他受中國進口關稅措施規限的材料。因此，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，中國政府對源自美國的晶圓及其他產品實施的關稅措施並未影響我們的採購成本或供應鏈穩定性。

展望未來，我們將繼續關注關稅政策，並在必要時調整進出口策略，以盡量降低任何潛在影響。

### 獎項及認可

我們所獲得的眾多獎項彰顯了我們的領先市場地位及品牌知名度。下表載列我們近年來獲得的重要獎項及認證：

編號	年份	得獎人	獎項／認可	頒發機構
1...	2025年	本公司	2025中國存儲器創新十強企業	世界半導體大會組委會、世界集成電路協會
2...	2025年	本公司	2025年第二十屆「中國芯」優秀市場表現產品獎	中國電子信息產業發展研究院 (CCID)
3...	2025年	本公司	2025年度行業創新引領者	國際科創節
4...	2025年	本公司	最佳綜合績效獎	中興
5...	2025年	本公司	「基於Y42M晶圓的LPDDR5芯片」被評為廣東省名優高新技術產品企業	廣東省高新技術企業協會
6...	2024年	本公司	「基於Z42M晶圓的LPDDR4芯片」被評為廣東省名優高新技術產品企業	廣東省高新技術企業協會
7...	2024年	本公司	年度IHV戰略合作夥伴	高通
8...	2024年	本公司	最佳合作夥伴獎	百度
9...	2024年	本公司	最佳服務支持獎	中興
10...	2023年	本公司	最佳交付獎	中興
11...	2025年	妙存科技	2025中國存儲控制器芯片市場最佳產品	世界半導體集成委員會、世界集成電路協會

## 業 務

編號	年份	得獎人	獎項／認可	頒發機構
12...	2025年	妙存科技	重點「小巨人」企業	廣東省工業和信息化廳
13...	2024年	妙存科技	2024年第十九屆「中國芯」優秀市場表現產品	中國電子信息產業發展研究院
14...	2024年	妙存科技	廣東省存儲器工程技術研究中心	廣東省科學技術廳

## 競爭

全球半導體存儲產品行業是一個龐大且快速增長的市場。根據弗若斯特沙利文的資料，以出貨量計，2024年全球半導體存儲產品市場規模達138億塊。隨著AI技術突破帶來的新的存儲需求與存儲產品本身的技術產品升級驅動，到2029年全球半導體存儲產品以出貨量計的市場規模將增長至194億塊，2024年至2029年的年複合增長率為7.1%。

我們主要參與全球半導體存儲產品行業中的全球嵌入式存儲產品市場。以出貨量計，2024年全球嵌入式存儲產品市場規模達86億塊，預計到2029年將增長至123億塊，年複合增長率為7.4%。

全球嵌入式存儲產品市場由存儲產品原廠(IDM)和獨立存儲器廠商組成。我們在該市場主要與全球及當地獨立存儲器廠商競爭。以2024年的出貨量計，前五大嵌入式存儲獨立廠商在獨立存儲器廠商中佔據35.4%的市場份額。我們在全球嵌入式存儲市場所有獨立存儲器廠商中排名第二，在獨立存儲器廠商中佔據8.2%的市場份額。

我們在市場上的主要競爭因素包括技術及研發能力、產品開發能力、穩定且優質的上游供應資源以及供應鏈導入能力。我們在存儲產品開發、生產及商業化等關鍵領域實力雄厚。我們提供廣泛的存儲產品以滿足不同領域多樣化的客戶需求。我們將繼續完善現有產品線，加大投資，以加速先進產品量產進程。此外，我們與半導體存儲產品價值鏈上的客戶及供應商建立了牢固的合作夥伴關係，增強了我們的競爭力。

## 業 務

### 僱員

截至2025年12月31日，我們在中國有504名全職僱員。下表載列截至2025年12月31日我們按業務職能劃分的僱員明細：

職責	僱員人數	百分比
技術及研發人員 .....	134	27%
生產人員 .....	167	33%
銷售人員 .....	73	14%
管理及行政人員 .....	130	26%
<b>總計 .....</b>	<b>504</b>	<b>100%</b>

下表載列截至2025年12月31日我們按地區劃分的僱員明細：

	僱員人數	百分比
深圳 .....	312	62%
珠海 .....	126	25%
中山 .....	63	12%
其他 .....	3	1%
<b>總計 .....</b>	<b>504</b>	<b>100%</b>

我們相信，我們的專業人才團隊是長期增長的基石。作為人力資源戰略的一部分，我們向僱員提供具競爭力的薪金、績效花紅及其他激勵措施，並通過市場調研持續優化我們的薪酬及激勵政策。我們主要通過內部引薦和推薦以及在線渠道招聘我們的中國僱員。根據政策，我們為所僱用的新僱員提供完善培訓計劃。我們亦因應不同部門僱員的需求，定期提供在線及線下專業培訓。

根據中國法律法規的規定，我們參與由相關地方市政及省級政府組織的各項僱員社會保險計劃，包括養老、醫療、工傷、生育及失業福利計劃。我們與大多數高級管理人員、經理及僱員簽訂有關保密、知識產權、僱傭關係、商業道德政策及競業禁止的標準合約及協議。截至最後實際可行日期，我們已成立工會。我們相信，我們與僱員維持良好工作關係，且於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無經歷任何對我們的營運造成重大不利影響的罷工或勞資糾紛。

---

## 業 務

---

### 保險

我們認為我們的承保範圍足夠，乃由於我們已根據中國法律及法規要求並符合一般市場慣例投購所有強制性保單。我們投購的僱員相關保險包括根據中國法律及法規規定購買的養老保險、生育保險、就業保險、工傷保險、醫療保險和住房公積金。我們亦為僱員購買附加意外保險。於往績記錄期間，我們並無就我們的業務提出任何重大保險索償。請參閱本文件「風險因素－與我們的業務及行業有關的風險－我們的保險保障或未能充分保障所有潛在的業務風險」。

### 物業

我們的公司總部位於廣東省深圳市。截至2025年12月31日，我們並無擁有任何物業。截至2025年12月31日，我們在深圳、中山、珠海及上海租賃八項物業，總建築面積約為18,000平方米，並在香港租有三項物業。我們的租賃物業主要用作生產、倉庫、業務及辦公室用途。

### 租賃登記

我們的中國法律顧問所示，根據中國法律法規，租賃協議一般須在當地土地和房地產管理局登記。截至2025年12月31日，主要由於出租人不配合，我們的四份租賃協議尚未按照適用法律法規的規定向中國相關房地產管理局登記及備案。根據中國法律顧問的意見，雖然未能登記並不會使租賃協議失效，但倘若該不合規事項未於接獲中國相關部門通知後的規定時限內糾正，出租人及承租人均可能面臨罰款。截至最後實際可行日期，該等四份租賃協議中的一份已向中國相關房地產管理局登記及備案。根據中國法律，未登記租賃的罰款可能為每份租賃人民幣1,000元至人民幣10,000元。倘我們因未能登記租賃協議而被處以任何罰款，我們或無法從出租人收回該等損失。因此，有關不合規的行政處罰最高金額將不超過人民幣30,000元。然而，截至最後實際可行日期，我們尚未被中國有關部門責令登記租賃協議或就該等租賃協議而被處以罰款。鑒於上述情況，董事認為，尚未登記該等租賃協議將不會對我們的業務運營造成重大不利影響。

---

## 業 務

---

### 超出許可用途範圍

此外，截至2025年12月31日，一處租賃物業的用途超出了房屋所有權證所登記的許可用途範圍。因此，相關部門可能要求恢復該物業的原始用途，從而可能導致我們無法繼續租賃該物業。我們的中國法律顧問表示，根據中國法律，我們將不會就該租賃物業受到任何行政處罰，但我們的租賃可能會受到影響，而我們可能因此須交吉相關物業並搬遷。我們可能須交吉相關物業及搬遷。我們的董事預期搬遷成本將低於人民幣130,000元，主要包括一次性搬遷費用、現有物業的復原費用以及新址裝修費用。目前場地附近有較多合適的搬遷選址可供選擇。合適的替代地點將需要有相似的約200平方米的面積，沒有任何業權瑕疵，並提供可比的租金成本。

若我們使用該等物業的權利受到質疑，我們將需於短時間內尋找替代物業並承擔搬遷成本，且尋找合適的替代物業並不存在障礙。

### 內部控制措施

我們已持續採取以下措施。對於尚未登記的租賃協議，我們正積極與出租人溝通以完成登記程序。在訂立任何未來租賃協議前，我們將確保審閱及核實出租人的物業所有權證，並要求出租人配合以完成適當的物業登記。在訂立任何未來租賃協議之前，我們將確保物業不會超出許可用途範圍。我們非物業活動的單一物業權益賬面值均未達到或超過我們資產總值的15%。

### 法律程序及合規

#### 法律程序

我們在日常業務過程中可能不時涉及法律程序。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，除下文所披露者外，我們或我們的任何董事並無未決或面臨威脅而可能單獨或共同對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響的訴訟、仲裁程序或行政程序。

---

## 業 務

---

### 未決商業機密訴訟

#### 背景

我們目前正涉及一項在中國的商業機密相關法律訴訟。於2020年，第三方（「原告」）深圳市江波龍電子股份有限公司以涉嫌侵害其商業機密為由，對本公司及兩名員工（員工A及員工B）提起訴訟，並要求共同賠償及判令停止其所指稱的不正當競爭行為。相關商業機密主要與LPDDR3產品的測試方法有關，我們主要於往績記錄期間開始前使用該方法。

員工A及員工B曾受僱於原告，分別擔任原告研發部門的軟件工程師及項目助理。彼等現時受僱於本公司。截至2025年12月31日，員工A及員工B在本公司擔任應用技術支持部經理及產品運營部經理。在一審中，原告聲稱其於2014年及2015年自主開發了LPDDR3測試技術，並將該技術視為商業機密。原告進一步指稱，員工A及員工B在受僱於原告期間曾接觸到該等商業機密，並在加入本公司後向本公司洩露相關商業機密。基於該等指控，原告聲稱本公司連同員工A及員工B侵犯了有關商業機密。

2023年，一審法院作出部分支持原告主張的一審判決（「一審判決」），並裁定(i)本公司、僱員A及B須立即停止任何侵權行為，停止擅自使用原告所屬的商業機密；(ii)本公司支付約人民幣14.2百萬元賠償金；及(iii)原告其餘所有主張均予駁回。

#### 近期發展

由於我們不服此判決，我們隨後向上訴法院提出上訴，要求推翻原判並駁回原告提出的所有主張。原告亦已向上訴法院提出上訴，主要要求增加一審判決所判給的賠償金額。我們已委聘外部知識產權訴訟律師（「知識產權訴訟律師」）天同律師事務所代表我們參與相關法律程序。據知識產權訴訟律師所告知，鑒於案件涉及商業機密性質，一審採用非公開形式進行，二審亦以非公開形式進行。截至最後實際可行日期，上訴已獲受理，二審仍在進行中。

## 業 務

### 潛在後果及影響

據知識產權訴訟律師所告知，儘管一審判決已作出，但由於案件現正處於二審上訴程序中，該判決尚未生效。這意味著一審中要求支付賠償金及停止任何侵權行為的命令尚未生效，目前對我們不構成任何約束性義務或影響。然而，基於審慎原則，我們已於2023年就裁定的賠償金額約人民幣14.2百萬元計提全額撥備。有關詳情，請參閱本文件「財務資料－經營業績主要組成部分說明－其他收入淨額」。

於2023年、2024年及2025年，銷售LPDDR3的收入貢獻分別約佔0.6%、0.002%及零。於往績記錄期間，該產品的毛利貢獻於任何年度均低於0.5%。此外，經知識產權訴訟律師確認，(i)商業機密所涉及的技术僅限於生產LPDDR3產品時的測試流程，(ii)商業機密所涉及的技术與LPDDR3的產品研發無關，及(iii)商業機密所涉及的技术與LPDDR4/4X的測試流程或研發無關。

截至最後實際可行日期，二審程序仍在進行中。在知識產權訴訟律師的代表下，我們正積極跟進此案，並相信我們擁有強而有力的論據及確鑿的證據支持，並且有其他材料可進一步鞏固我們的立場。

經考慮一審法院的證據及截至最後實際可行日期已提交二審程序的新證據，知識產權訴訟律師認為，原告於上訴中部分勝訴而導致本公司須支付金額超出一審判決的可能性甚微。即使本公司的主張未獲二審法院完全認可，知識產權訴訟律師確認，根據相關中國法律及適用司法詮釋，本案損害賠償的計算基準應收窄至相關LPDDR3測試流程應佔經營利潤的部分，由於所涉及的商業機密僅涉及該測試流程中的一部分而非全部機密元素，因此進一步應用適當的分配比率。

經考慮知識產權訴訟律師的法律意見後，董事認為任何進一步經濟流出的風險甚微，主要由於(i)我們有充分理據主張原告指控缺乏依據；及(ii)儘管我們不服一審判決，惟已根據該判決計提全額撥備。此外，於往績記錄期間，被指控技術所貢獻的收入及利潤微乎其微，因相關技術已被更先進的LPDDR4/4x及後續LPDDR產品測試技術所取代，被指控的LPDDR3測試方法並不適用於當前業界廣泛採用的LPDDR產品。該等先進技術並非基於爭議技術開發而成。

---

## 業 務

---

### 內部控制方法

為確保妥善管理我們的知識產權及商業機密，並避免發生涉及知識產權及商業機密侵權的訴訟，我們已實施多項內部政策，並建立了內部知識產權管理體系。我們已建立並實施完善的內部政策，用於管理知識產權及商業機密，並指定專門人員負責其應用、執行、維護及監督。同時，我們定期對知識產權管理框架進行審查，以確保其持續實用性和有效性。為支持知識產權及商業機密的有效管理，我們已建立內部知識產權管理體系，涵蓋專有權利的全生命週期，包括專利的申請、維護及價值評估等。為防範對我們及他人知識產權和商業機密的潛在侵權，我們的法務部門在研發項目及技術研發完成後，會對研發成果進行全面檢索與分析，包括評估潛在侵權風險，並對研究成果進行詳盡審查。此外，我們定期對員工進行培訓，以確保其充分理解並遵守知識產權政策。此外，我們在招聘時會對候選人進行背景調查，以確認其是否受前僱主競業禁止約束，從而降低潛在的知識產權侵權風險。我們要求員工遵守與商業機密相關的保密義務，簽署保密及競業禁止協議，並遵循內部保密政策，其中規定了保護知識產權的具體責任。

### 監管合規

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾且並未涉及任何導致罰款、執法行動或其他處罰的重大不合規事件，而可能單獨或共同對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，經我們的中國法律顧問確認，我們在所有重大方面一直遵守所有適用法律及法規。

### 社會保險及住房公積金

#### 背景

根據相關中國法律，我們須為中國內地僱員繳納社會保險及住房公積金。於往績記錄期間，本公司若干附屬公司並無根據相關中國法律為其部分僱員全額繳納社會保

---

## 業 務

---

險及住房公積金。於2023年、2024年及2025年，我們估計欠繳的社會保險及住房公積金分別約為人民幣2.9百萬元、人民幣4.5百萬元及人民幣5.5百萬元。

董事確認，不合規主要是由於(i)若干僱員因需要其額外繳納而不願全額繳納社會保險及住房公積金；及(ii)部分僱員選擇在其居住地或家鄉參加農村社會保障繳納計劃。

### 潛在法律後果及影響

誠如中國法律顧問所告知，根據相關中國法律，(i)倘於規定期間內欠繳社會保險，或須按日繳納欠繳款項萬分之五的滯納金，且倘未在規定期間內支付款項，主管部門可進一步處以逾期金額一倍至三倍的罰款；及(ii)就未繳存的住房公積金而言，我們可能被責令在指定期限內繳付未繳存的住房公積金。逾期不繳存未繳住房公積金的，可以申請人民法院強制執行。誠如中國法律顧問所告知，並無法律條文或法規明文規定對本集團未繳付住房公積金作出處罰，但我們可能被責令於規定期限內繳付未繳的住房公積金。

2025年7月31日，最高人民法院發佈了《最高人民法院關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(二)》(「《司法解釋(二)》」)，該解釋自2025年9月1日起施行。《司法解釋(二)》第十九條第一款規定，用人單位與勞動者約定或者勞動者承諾無需繳納社會保險費的，人民法院應當認定該約定或者承諾無效。此外，如用人單位未依法繳納社會保險費，勞動者根據《中華人民共和國勞動合同法》第三十八條第三款規定請求解除勞動合同、由用人單位支付經濟補償的，人民法院應依法予以支持。根據《司法解釋(二)》，用人單位與勞動者就不繳納社會保險達成的任何協議或員工承諾放棄繳納社會保險，均由人民法院判定為無效。

考慮到於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，(i)概無員工就繳納社會保險提起訴訟或仲裁；(ii)有關監管機構並無就我們的社會保險繳納對我們採取任何行政行動或處罰，董事認為實施《司法解釋(二)》不會對我們的業務或財務業績造成重大不利影響。

## 業 務

為防範未來可能出現的違規行為，我們計劃定期為員工舉辦相關法律法規的守法培訓，以提高員工對社會福利計劃的認知，並鼓勵員工參加社會福利計劃。

我們的中國法律顧問認為：(i)《司法解釋(二)》未廢除中國現行有效的社會保險法律法規；及(ii)概無員工就繳納社會保險提起訴訟或仲裁，故本公司並無未決訴訟或仲裁適用《司法解釋(二)》。

截至最後實際可行日期，相關監管機構未對我們的社會保險繳納及住房公積金採取行政行動、罰款或處罰，我們亦未收到任何結清差額的命令或通知。我們亦不知悉有任何僱員投訴或要求繳納社會保險或住房公積金。

我們已取得專項信用報告，每份報告均顯示相關附屬公司於往績記錄期間並無受到任何行政處罰。誠如中國法律顧問所確認，專項信用報告由政府主管部門授權的徵信機構出具，乃由於國家發改委及其他政府機關正推行以專項信用報告取代書面合規證書。

根據人力資源和社會保障部於2018年9月21日頒佈的《關於貫徹落實國務院常務會議精神切實做好穩定社保費徵收工作的緊急通知》，行政執法部門不得擅自組織對企業歷史社會保險欠費進行集中清繳。

鑒於以上所述，我們的中國法律顧問認為，倘當前與社會保險及住房公積金相關的政策、法規及地方政府執行及監管規定並無重大變動：(i)我們因未能全額繳納社會保險及住房公積金而被處罰的風險極低；及(ii)我們被中國有關部門要求補交社會保險及住房公積金的風險極低。因此，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無就欠繳的社會保險及住房公積金計提任何撥備。

### **內部控制及改正措施**

我們持續採納以下措施，包括繼續定期與相關地方政府部門溝通，並在必要時就按相關政府部門批准的比率計算社會保險費及住房公積金的適用基準諮詢中國法律顧問，並根據諮詢結果更新相關繳納政策；已經並將繼續向我們的人力資源員工提供有關社會保險及住房公積金繳納合規要求以及相關法律及法規的定期培訓；已根據適用

## 業 務

法律及法規完善我們的人力資源管理政策；及已指派人力資源員工每月審查及監控社會保險及住房公積金的申報及繳納。

倘相關部門責令我們日後全額繳納社會保險及／或住房公積金，我們承諾將在規定期限內迅速全額繳納及／或立即採取改正措施。

### 證書、許可證及執照

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已取得在所有相關司法權區開展業務所需的所有重要執照、批文及許可證。據我們的中國法律顧問告知，倘現行法律法規並無重大變動，我們預期在中國重續任何執照、批文及許可證(如需要)方面不會存在任何重大法律障礙。

下表載列我們目前持有的重大執照、批文及許可證清單：

實體	執照、批文及許可證名稱	屆滿日期
本公司	出入境檢驗檢疫報檢企業	不適用
本公司	海關報關單位註冊登記證書	不適用
妙存科技	出入境檢驗檢疫報檢企業	不適用
妙存科技	海關報關單位註冊登記證書	不適用
晶存技術	報關單位備案證明	不適用
中山晶存	報關單位備案證明	不適用

此外，倘現行法律法規並無重大變動，我們預期在所有相關司法權區重續不時需要的執照、批文及許可證方面不會遇到任何重大法律障礙。

---

## 業 務

---

### 風險管理及內部控制

我們已建立及目前正執行風險管理及內部控制制度（包括我們認為對業務營運而言屬合適的政策及程序）。我們致力不斷完善該等制度。我們已在多個業務與營運層面採取及實施全面的風險管理政策，例如信息技術、財務報告及內部監控。董事會負責建立及更新本公司的內部控制制度，而高級管理層則監督各附屬公司及職能部門的內部控制程序及措施的日常實施情況。

為監督於[編纂]後持續實施我們的風險管理政策及企業管治措施，我們已採取或將繼續採取（其中包括）下列風險管理措施：成立審計委員會以檢討及監督我們的財務報告程序及內部控制制度。有關委員會成員資格及經驗的更多詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」；加強報告及記錄保存系統，包括實施銷售管理報告及記錄系統，將訂單控制及客戶管理集中處理；定期為高級管理層及僱員提供有關職業行為要求及道德標準的培訓，以提高其對適用法律法規的了解及遵從水平，並將針對不合規行為的相關政策納入員工紀律措施及監督指引；及為董事及高級管理層安排有關上市規則相關規定及香港上市公司董事職責的培訓課程。

為確保將上述合規文化嵌入日常工作流程並為整個組織內的個人行為設定期望，我們將定期檢討我們的風險管理政策及內部管理程序、採取嚴格的內部問責制及進行合規培訓。